PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-270535

(43) Date of publication of application: 09.10.1998

(51)Int.CI.

B23Q 1/44 G03F 7/20 H01L 21/027

(21)Application number: 09-071466

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

25.03.1997

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the static

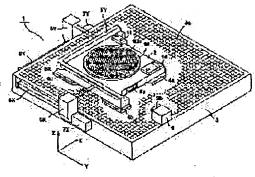
(72)Inventor: NISHI TAKECHIKA

KIUCHI TORU

(54) MOVING STAGE DEVICE AND CIRCUIT-DEVICE MANUFACTURE USING THE SAME (57)Abstract:

characteristics and dynamic characteristics of a stage device, by decreasing the number of electric wirings and air pressure tubes drawn by the main body of the movable stage of the moving stage device. SOLUTION: When a movable stage structure 2 comes to a wafer replacing position on a base structure constituting a moving stage device 1, a power transmitting terminal 9a provided on the side of the base structure and a power receiving terminal 9a provided on the side of the movable stage structure are brought into contact. The current supplied from the power transmitting terminal 9b charges the battery mounted on the movable stage structure 2. Thereafter, when the stage structure is separated from the wafer replacing position, the electric power of the battery is used, and the wafer mounted on the stage structure is electrically

suckled and maintained. The control for the starting of



the sucking, the release of the sucking and the like at the time of wafer replacing work is performed by a radio communication method or a wire coupler method in this constitution.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

-. / /.........10 indl inc ro in /DA1 /result /detail/main/wAAAIJIaaG6DA410270535P1... 2003/07/08

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-270535

(43)公開日 平成10年(1998)10月9日

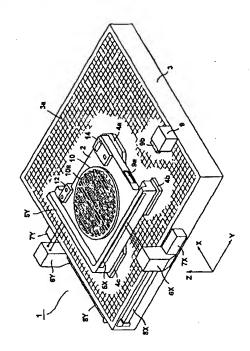
(51) Int.Cl.		識別記号		FI					
H01L	21/68			H 0	1 L	21/68		K	
		,						P	
B 2 3 Q	1/44			G 0	3 F	7/20		521	
G03F	7/20	5 2 1		Н0	1 L	21/30		503B	
H01L	21/027							515G	
	•		審查請求	未請求	諸才	マ項の数41	OL	(全 45 頁)	最終質に続く
(21)出願番		特願平9-71466		(71)	出願人	人 000004	112	T. V.	
						株式会	社ニコ	ン	
(22)出願日		平成9年(1997)3月25日				東京都	千代田	区丸の内3丁	目2番3号
,,,,,,,,		.,		(72)	発明	者 西 健	W		
						東京都	千代田	区丸の内3丁	目2番3号 杉
						式会社	•		
				(72)	発明		•	• •	
				(12)	7691			は かいなるエ	目2番3号 杉
	`					式会社			D PHO () A
				1,					
				1					
				İ					
				1					

(54) 【発明の名称】 移動ステージ装置、及び該ステージ装置を用いた回路デバイス製造方法

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 移動ステージ装置の可動ステージ本体が引き ずる電気配線や空圧用チューブの本数を低減して、ステ ージ装置の静特性、動特性を改善する。

【解決手段】 移動ステージ装置 1 を構成するベース構造体上で可動ステージ構造体 2 がウェハ交換位置にきたとき、ベース構造体側に設けられた送電端子部 9 b と可動ステージ構造体側に設けられた受電端子部 9 a とを接触させ、送電端子部 9 b から供給される電流を受電端子部を介して可動ステージ構造体 2 に搭載されたバッテリーに充電するようにし、ステージ構造体がウェハ交換位置から離れたときはバッテリーの電力を使ってステージ構造体上に載置されるウェハを電気的に吸着維持するようにし、ウェハの交換動作の際の吸着開始、吸着解除等の制御を無線式又は有線のカブラ方式で行うように構成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ベース構造体と、該ベース構造体で規定される所定平面に沿って移動するステージ構造体と、前記ステージ構造体上で被処理基板を保持する基板載置部とを有する移動ステージ装置において、

前記ステージ構造体を前記ベース構造体から浮上させた 状態で前記ベース構造体の所定平面に沿って非接触方式 で移動させる電気的駆動手段と、前記被処理基板を前記 基板載置部に吸着させる電気的吸着手段と、前記ステー ジ構造体に設けられて電気エネルギーを蓄積する再充電 10 可能なバッテリーと、前記ステージ構造体に設けられて 前記電気的駆動手段と前記電気的吸着手段の少なくとも 1つに前記バッテリーからの電気エネルギーを制御して 供給する給電制御回路と、前記ステージ構造体に設けら れて前記給電制御回路の動作を指示する制御情報を受信 する受信回路とを備えたことを特徴とする移動ステージ 装置。

【請求項2】 前記受信回路は、電気的駆動手段と前記電気的吸着手段のうち少なくとも1つの動作を制御するコマンド情報又はパラメータ情報を、無線電波で受信 20 するトランスミッターを含むととを特徴とする請求項1 に記載の装置。

【請求項3】 前記電気的駆動手段は電磁気学的な推力を発生する複数の電磁アクチュエータを含み、前記給電制御回路は前記複数のアクチュエータの各々に制御された推力を発生させる電力を前記トランスミッターで受信したコマンド情報やパラメータ情報に基づいて出力する複数の駆動回路を含むことを特徴とする請求項2に記載の装置。

【請求項4】 前記電気的吸着手段は前記基板載置部 30 に形成された静電吸着用の電極部を含み、前記給電制御 回路は前記トランスミッターで受信したコマンド情報や パラメータ情報に基づいて前記電極部に吸着用高電圧を 供給する高電圧発生回路を含むことを特徴とする請求項 2 に記載の装置。

【請求項5】 ベース構造体と、該ベース構造体で規定される所定平面に沿って移動するステージ構造体と、該ステージ構造体上で被処理基板を保持する基板載置部とを有する移動ステージ装置において、

前記被処理基板を前記基板裁置部に静電吸着させる静電 40 吸着手段と、前記ステージ構造体に設けられた再充電可能なバッテリーと、前記ステージ構造体に設けられて前記バッテリーからの電気エネルギーを前記静電吸着手段に制御して供給する給電制御回路と、前記ステージ構造体に設けられて前記給電制御回路の動作を指示する制御情報を受信する受信回路とを備えたことを特徴とする移動ステージ装置。

【請求項6】 前記受信回路は、前記静電吸着手段の 動作を制御するための制御情報を無線方式で受信するト ランスミッターを含むととを特徴とする請求項5 に記載 50 の装置。

【請求項7】 前記静電吸着手段は前記基板載置部に 形成された静電吸着用の電極部を含み、前記給電制御回 路は前記トランスミッターで受信した制御情報に基づい て前記電極部に吸着用高電圧を供給する高電圧発生回路 を含むことを特徴とする請求項6 に記載の装置。

【請求項8】 前記受信回路は、前記ステージ構造体が前記被処理基板を受け取るためのローディング位置に移動されたときに前記ベース構造体側に設けられた送信ユニットの送電端子部と接続される受電端子部を有し、前記給電制御回路は、前記ステージ構造体がローディング位置に停止している間に前記受電端子部を介して受信した前記制御情報に応答して、前記静電吸着手段による被処理基板の吸着動作、又は吸着開放動作を開始するととを特徴とする請求項5に記載の装置。

【請求項9】 前記被処理基板は半導体素子や液晶表示素子を製造するための感応基板であり、前記移動ステージ装置は大気以外の雰囲気で前記感応基板上に所望の回路パターンを転写する露光装置に搭載されることを特徴とする請求項5に記載の装置。

【請求項10】 ベース構造体上で移動可能なステージ 構造体を予め記憶された制御プログラムに従って移動さ せ、前記ステージ構造体上に交換可能に載置される複数 枚の被処理基板の各々に回路バターンを転写することに より、前記被処理基板上に回路デバイスを形成する製造 方法において、

前記被処理基板を前記ステージ構造体上に吸着固定するための第1アクチュエータと前記被処理基板を前記ステージ構造体上で3自由度以上で微動させるための第2アクチュエータとの少なくとも一方に電気エネルギーを供給する充電可能なバッテリーと、該バッテリーを充電するための電気的な受端部とを前記ステージ構造体に設け、前記ステージ構造体が所定のスタンバイ位置に位置付けられると前記受端部と接続されて前記バッテリーへの充電電流を出力する送端部を前記ベース構造体に設け、前記複数枚の被処理基板が処理される間の適宜の時点で、前記バッテリーの充電のために前記ステージ構造体を前記スタンバイ位置へ移動させるコマンド又はバラメータを前記制御プログラムの一部として登録可能にしたことを特徴とする回路デバイス製造方法。

【請求項11】 前記スタンバイ位置は、前記被処理基板を前記ステージ構造体上に受け渡すためのローディング位置に設定され、前記被処理基板の交換作業の時間を利用して前記バッテリーを充電することを特徴とする請求項10に記載の方法。

【請求項12】 前記送端部と前記受端部とは、前記制御プログラムから出力される前記被処理基板の吸着開始と吸着解除とを表わす指令信号を送受信する通信カプラ部を備え、前記制御プログラムは前記ステージ構造体を前記ローディング位置に移動させて前記被処理基板の吸

10

着開始または吸着解除を実行するととを特徴とする請求 項11に記載の方法。

【請求項13】 前記ステージ構造体は大気以外の雰囲 気に設定され、該雰囲気内で前記被処理基板上に所望の 回路パターンを転写することを特徴とする請求項12に 記載の方法。

【請求項14】 ベース構造体と、該ベース構造体上の 所定平面に沿って移動するとともに一部に被処理基板を 減圧吸着する載置面が形成されたステージ構造体とを備 えた移動ステージ装置において、

前記ベース構造体の一部に設けられて前記ステージ構造 体の載置面に被処理基板を吸着するための負圧気体を送 り出す送端口と、前記ステージ構造体が所定の待機位置 に移動したときに前記送端口と係合し得るように前記ス テージ構造体の一部に設けられて、前記負圧気体を前記 ステージ構造体側に取入れる受端口と、該受端口から前 記ステージ構造体の載置面までの間に形成される前記負 圧気体の通路を開閉する弁機構と、前記ステージ構造体 が前記待機位置に移動して前記送端口と前記受端口とが 係合している間は前記弁機構を開状態にし、前記送端口 20 と前記受端口とが非係合の間は前記弁機構を閉状態にす る制御手段とを備えたことを特徴とする移動ステージ装

【請求項15】 前記被処理基板の吸着時に前記ステー ジ構造体の載置面と前記被処理基板との間のリークで生 じる吸着力の低下を補うために、前記弁機構から前記載 置面までの前記負圧気体の通路と連通する予備負圧室を 設けたことを特徴とする請求項14に記載の装置。

【請求項16】 前記ステージ構造体は、軽量化のため 作られ、前記予備負圧室は前記構造部材の空洞を気密状 態にして構成したことを特徴とする請求項15に記載の

【請求項17】 前記セラミックス系の構造部材は前記 被処理基板を載置して吸着するホルダーであることを特 徴とする請求項16に記載の装置。

【請求項18】 前記弁機構は前記制御手段から出力さ れる切り換え信号に応答して前記負圧気体の通路を開放 状態と遮断状態とに切り換える電磁弁を含むことを特徴 とする請求項14に記載の装置。

【請求項19】 前記ベース構造体と前記ステージ構造 体には、前記受端口と前記送端口とが係合したときに互 いに電気的に接続する送電端子と受電端子とが設けら れ、前記電磁弁に与えられる切り換え信号を前記ベース 構造体から前記送電端子と受電端子とを介して供給する ことを特徴とする請求項18に記載の装置。

【請求項20】 ベース構造体と、該ベース構造体上の 所定平面に沿って移動するとともに一部に被処理基板を 減圧吸着する載置面が形成されたステージ構造体とを備 えた移動ステージ装置において、

前記ベース構造体の一部に設けられて、前記ステージ構 造体の載置面に被処理基板を吸着するための負圧気体を 送り出す送出機構と、前記ステージ構造体が所定の待機 位置に在るときに前記送出機構と係合し得るように前記 ステージ構造体の一部に設けられ、前記送出機構と係合 中は前記送出機構からの負圧気体を前記ステージ構造体 の載置面に導き、前記送出機構と非係合の間は外気との 流通が遮断される受入機構とを含むことを特徴とする移 動ステージ装置。

【請求項21】 前記受入機構は、前記ステージ構造体 の移動推力を利用した押圧動作によって前記送出機構か らの前記負圧気体の通路を開放するピストンを備えたと とを特徴とする請求項20に記載の装置。

【請求項22】 前記ステージ構造体は、前記受入機構 から前記載置面に至る前記負圧気体の通路の一部と連通 した予備負圧室を備え、前記送出機構と前記受入機構と が非係合の間は前記予備負圧室内の負圧気体によって前 記被処理基板の吸着を持続させることを特徴とする請求 項20に記載の装置。

【請求項23】 前記送出機構は、前記ステージ構造体 の載置面に吸着された被処理基板を速やかに取り外すた めに、前記受入機構が前記送出機構と係合したときに前 記予備負圧室から前記載置面に至る負圧気体の通路に加 圧気体を供給する気体供給系を備えることを特徴とする 請求項22に記載の装置。

【請求項24】 前記送出機構は前記負圧気体または前 記加圧気体の送出と遮断とを切り換える電磁弁を備え、 前記受入機構は前記送出機構との係合中に前記予備負圧 室に至る負圧気体の通路を開放し、非係合の間はその通 に内部に空洞が形成されたセラミックス系の構造部材で 30 路を遮断する電磁弁を備えるととを特徴とする請求項2 3に記載の装置。

> 【請求項25】 回路パターンが形成されたマスク基板 を吸着保持して走査露光の際に少なくとも1次元に移動 可能な第1ステージ構造体と、前記回路パターンが露光 される被露光基板を吸着保持して走査露光の際に少なく とも1次元に移動可能な第2ステージ構造体とを備えた 投影露光装置を用いて、前記被露光基板上に前記回路バ ターンの像を形成する方法において、

前記マスク基板を前記第1ステージ構造体上に所定時間 に渡って継続的に吸着するのに必要なエネルギーが蓄積 される第1蓄積部材を前記第1ステージ構造体に搭載 し、前記第1ステージ構造体が前記マスク基板を交換す るための待機位置に位置したときは前記第1蓄積部材に 新たなエネルギーを補充可能とし、前記第1ステージ機 造体が待機位置から離れている間は前記第1蓄積部材か らのエネルギーによって前記マスク基板の自立吸着を継 続させる段階と;前記被露光基板を前記第2ステージ構 造体上に所定時間に渡って継続的に吸着するのに必要な エネルギーが蓄積される第2蓄積部材を前記第2ステー 50 ジ構造体に搭載し、前記第2ステージ構造体が前記被露

光基板を交換するための待機位置に位置したときは前記第2 蓄積部材に新たなエネルギーを補充可能とし、前記第2 ステージ構造体が待機位置から離れている間は前記第2 蓄積部材からのエネルギーによって前記被露光基板の自立吸着を継続させる段階と;を含むことを特徴とする回路デバイス製造方法。

【請求項26】 前記投影露光装置は、前記第1ステージ構造体の1次元移動方向と直交した方向にスリット状もしくは長方形に延びた紫外線照明光を、前記マスク基板の回路パターンの一部に照射する照明系を備えたこと 10を特徴とする請求項25に記載の方法。

【請求項27】 前記第1ステージ構造体への前記マスク基板の吸着、或いは前記第2ステージ構造体への前記被露光基板の吸着のためのエネルギーを減圧気体とするために、前記第1蓄積部材または前記第2蓄積部材は前記減圧気体を所定の容積で密閉するタンクで構成されるととを特徴とする請求項26に記載の方法。

【請求項28】 前記タンク内の減圧気体によって前記マスク基板又は前記被露光基板の自立吸着を継続させるために、前記第1ステージ構造体または前記第2ステー 20ジ構造体が待機位置に位置したときは前記タンク内に減圧気体を導き、待機位置から離れている間は前記タンクの外気への開放を遮断する弁機構を、前記第1ステージ構造体または前記第2ステージ構造体に設けたことを特徴とする請求項27に記載の方法。

【請求項29】 前記第1ステージ構造体への前記マスク基板の吸着、或いは前記第2ステージ構造体への前記被露光基板の吸着のためのエネルギーを静電圧とするために、前記第1蓄積部材または前記第2蓄積部材は前記静電圧を発生するための電気回路系に電力を供給する30再充電可能なバッテリーで構成されることを特徴とする請求項26に記載の方法。

【請求項30】 ベース構造体の上を移動するステージ 構造体に被処理基板を保持し、前記ステージ構造体の移 動により前記被処理基板上に所望の回路バターンを露光 するリソグラフィ装置を用いて、前記被処理基板上に回 路デバイスを形成する製造方法において、

前記ベース構造体上の所定のローディング位置に向けて 被処理基板を搬送すると共に、前記ステージ構造体をロ ーディング位置に移動させる段階と:前記ローディング 40 位置において前記被処理基板を前記ステージ構造体の基 板載置部上に受け渡す段階と;前記ステージ構造体がロ ーディング位置に在る間は、前記ステージ構造体内に形 成される閉空間部で必要な減圧気体または加圧気体を前 記ステージ構造体に設けられた受端口を介して供給する 段階と;前記ステージ構造体がローディング位置から離 れている間は前記受端口を介して前記閉空間部が外気に 連通することを遮断する段階とを含むことを特徴とする 回路デバイス製造方法。

【請求項31】 前記ステージ構造体の基板載置部は前 50 を特徴とする請求項37に記載の製造方法。

記被処理基板を減圧吸着して平坦化矯正する基板ホルダを含み、前記ステージ構造体内に形成される閉空間部は、前記基板ホルダの載置面上に前記被処理基板が載置されたときに前記載置面に形成される減圧吸着部を含むことを特徴とする請求項30に記載の製造方法。

【請求項32】 前記ステージ構造体内の閉空間部は、前記基板ホルダの載置面と前記被処理基板との間の吸着力を持続させるために、前記ステージ構造体又は基板ホルダ内に形成されて前記減圧吸着部と連通した容積拡張室を含むことを特徴とする請求項31に記載の製造方法。

【請求項33】 前記容積拡張室を前記基板ホルダ内に 形成する場合は、前記容積拡張室の減圧による前記載置 面の変形を低減するために前記容積拡張室を球型又は円 筒型を基本として造形することを特徴とする請求項32 に記載の製造方法。

[請求項34] 前記ステージ構造体の基板載置部は前記被処理基板を保持して前記ステージ構造体上で微小移動可能な基板ホルダで構成され、前記ステージ構造体内に形成される閉空間部は、前記基板ホルダと前記ステージ構造体との間に設けられた吸着パッド部への減圧路を含むことを特徴とする請求項30に記載の製造方法。

【請求項35】 前記ステージ構造体は、前記ローディング位置において被処理基板を前記基板載置部に対して上昇、降下させるリフト機構を有し、前記ステージ構造体内に形成される閉空間部は、前記リフト機構を減圧気体または加圧気体によって作動させる空力駆動源のシリンダ部を含むことを特徴とする請求項30に記載の製造方法。

【請求項36】 前記リソグラフィ装置は前記ステージ 構造体を予め記憶された制御プログラムに応答して移動 させるステージ制御器を有し、前記ステージ構造体は前 記閉空間部の圧力を検知するセンサを有し、該センサに よる検知圧力が所定範囲から外れると警報信号を発生す ることを特徴とする請求項30に記載の製造方法。

【請求項37】 前記制御プログラムは、前記ステージ 構造体の移動により前記被処理基板上に設定される複数 のショット領域の各々に前記回路パターンを順次露光す る処理の実行中に前記警報信号が発生されると、前記露 光処理を中断して前記ステージ構造体をローディング位 置に移動させる処理中断動作を実行することを特徴とす る請求項36に記載の製造方法。

【請求項38】 前記ステージ構造体は前記受端口から前記閉空間部までの気体通路を開放/遮断する電磁弁を有し、前記制御プログラムは、前記ステージ構造体がローディング位置に停止している間に前記電磁弁を開放/遮断する弁制御プログラムと、該電磁弁の遮断直後から前記センサによる検知圧力を監視して該監視結果に応じて前記警報信号を作る監視プログラムとを実行することを特徴とする語はで37に記載の製造方法

【請求項39】 前記監視プログラムは、前記センサに よる検知圧力が前記ステージ構造体内の閉空間部による 所期の機能が維持され得る第1許容値から外れたときは 第1警報信号を作り、前記閉空間部による所期の機能が 維持不能とみなせる第2許容値から外れたときは第2警 報信号を作ることを特徴とする請求項38に記載の製造 方法。

【請求項40】 前記処理中断動作は、前記露光処理の ための被処理基板が前記ステージ構造体上に載置されて いる間に前記第1警報信号が発生した場合は、前記ステ ージ構造体をローディング位置に戻して前記弁制御プロ グラムを再実行させる機能を含むことを特徴とする請求 項39に記載の製造方法。

【請求項41】 前記処理中断動作は、前記露光処理の ための被処理基板が前記ステージ構造体上に載置されて いる間に前記第2警報信号が発生した場合は、前記ステ ージ構造体の移動を停止させて前記リソグラフィ装置の 点検が必要であることを表す点検要求信号を発生する機 能を含むことを特徴とする請求項40に記載の製造方

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、リソグラフィ装置 や計測装置等に使われる精密な移動ステージ装置とその ステージ装置を用いた回路パターンの製造方法に関し、 特に半導体デバイスや液晶表示デバイスを製造するリソ グラフィ工程で使用される露光装置用のステージ装置 と、そのような露光装置を使って感応基板上にデバイス パターンを形成する製造方法とに関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、半導体デバイスの製造現場の リソグラフィ工程では各種の露光装置が使用されてい る。その露光装置として、現在のところ量産ライン内で 主流をなしているのはステップアンドリピート方式の縮 小投影露光装置 (ステッパー) である。その他に、回路 パターンの原版としてのマスクとデバイス製造用の感光 基板(例えば半導体ウェハ)とを投影光学系に対して相 対走査するステップアンドスキャン方式の投影露光装置 (スキャン露光機)、マスクと感応基板とを一定のギャ ップ間隔に設定してSOR等のX線によってステップア 40 ンドリピート露光するX線ステッパー、荷電粒子ピーム によって回路パターンを描画したり電子放射マスクを転 写する電子線露光装置等が知られている。

【0003】そしてとれらの露光装置の多くは、感光性 又は感応性の基板(レジスト層を塗布した半導体ウェ ハ)を保持してパターン投射系 (パターン像の投影系や マスク自体)に対して2次元移動する移動ステージ装置 を備えている。その移動ステージ装置にも各種の方式が 知られており、可動ステージ本体をベース定盤のガイド するように構成し、送りネジとナットによる接触式の駆 動源や複数のリニアモータを組み合わせた非接触式の駆 動源で移動させる方式が知られている。

【0004】いずれにしろこれらのステージ装置には、 基板を吸着保持する真空吸着方式のホルダーや各種の空 力作動源(ビストン、真空バッド部等)に真空圧、加圧 気体を供給するための複数のフレキシブルチューブが配 管されている。従って、可動ステージ本体はこれらのフ レキシブルチューブをベース定盤に対して引きずって移 10 動することになる。同様に可動ステージ本体内には各種 の電気的駆動源(回転モータ、、ボイスコイルモータ、 ピエゾ素子、電磁石等) が設けられ、これらの電気的駆 動源に対しても電気エネルギー供給用の複数の電気配線 がベース定盤側、或いは装置コラム側から結線され、可 動ステージ本体はこれらの配線を引きずって移動するこ とになる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】従来のステージ装置に おいて、非接触なガイド構造を採るエアガイドステージ 20 と非接触式のリニアモータとを組み合わせた構成では、 可動ステージ本体の座標位置を計測するレーザ干渉計か らの計測値が、指令された目標位置に対して所定の誤差 範囲(例えば±0.04μm)内になるように複数のリ ニアモータをサーボ制御している。従って可動ステージ 本体の移動安定性や静止安定性は、ガイド面での摺動部 や駆動源内の機械的な接触部が無いために、主にリニア モータの駆動特性 (トルクむら等) やサーボ特性に依存

【0006】とのため、可動ステージ本体を目標速度に 30 対して例えば±0.01%以内の高い精度で等速移動さ せたり、目標位置に対して例えば±0.04 um以内に 静止させたりする場合、ステージ本体はフレキシブルチ ューブや電気配線の引っ張り力 (テンション)の変化、 チューブや配線自体の振動等を含んでサーボ制御され、 結果的に等速性や静止精度が所望の規格から悪化すると とが起り得る。

【0007】特に、可動ステージ本体の周波数応答性を 高めるためにステージ本体をセラミック材のハニカム構 造(中空構造)にして軽量化した場合、フレキシブルチ ューブや電気配線を伝わってくる空調チャンバー内の動 力源の振動、空調チャンパーからの送風による空気振動 (音波) がステージ本体の動特性、静特性に影響し易く なり、基板上に形成される回路パターンの転写位置精 度、解像力、重ね合わせ精度を劣化させる原因となると いった問題がある。

【0008】そとで、可動ステージ本体をX、Y(及び Ζ. θ) 方向に駆動させる各種の駆動アクチュエータ (モータ、電磁石等)の出力容量を強大なものにし、サ ーボ制御時のループゲインを大きくすれば、チューブや 面に対してニートルベアリングやエアベアリングで支持 50 配線のテンションの影響や各種振動の影響を受けにくい 20

サーボ特性を得ることは可能である。しかしながら駆動 源の出力容量の強大化は発熱の増大を招き、その結果、 レーザ干渉計の光路内の空気に温度ゆらぎ、屈折率変動 が生じて測長精度が劣化するといった別の問題が起り得

【0009】そこで本発明は、可動ステージ本体に接続 される各種チューブや配線の影響によって動特性や静特 性が劣化することを防止したステージ装置を得ることを 1つの目的とし、また交換可能に基板を真空吸着する機 能を備えた可動ステージに接続される減圧気体(真空 圧)供給用のチューブを取り除いたステージ装置を得る ことを1つの目的とする。さらに本発明では、そのよう なステージ装置を搭載して半導体素子、液晶表示素子用 の回路デバイスを露光処理するリソグラフィ露光装置を 提供すること、及びそのような露光装置の改良された操 作方法を利用した回路パターン (デバイスパターン)の 製造方法を提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決する為の構成】本願の請求項1に記載の発 明は、ベース構造体(定盤3)と、ベース構造体(3) で規定される所定平面 (XY平面) に沿って移動するス テージ構造体(可動ステージ本体2)と、ステージ構造 体(2)上で被処理基板(ウェハW等)を保持する基板 載置部(ホルダ10)とを有する移動ステージ装置 (1) に適用される。

【0011】そして本願発明では、ステージ構造体 (2)をベース構造体(3)から浮上させた状態でベー ス構造体(3)の所定平面(規定平面3a)に沿って非 接触方式で移動させる電気的駆動手段(電磁推進ユニッ 基板載置部(10)に吸着させる電気的吸着手段(静電 吸着用の電極 I O a) と、ステージ構造体(2) に設け られて電気エネルギーを蓄積する再充電可能なバッテリ ー (ニッカド・バッテリー100)と、ステージ構造体 (2) に設けられて電気的駆動手段(4a~4d)と電 気的吸着手段(10a)の少なくとも1つにバッテリー (100) からの電気エネルギーを制御して供給する給 電制御回路(CPU110, 高電圧制御回路112, ド ライブ回路114、116)と、ステージ構造体(2) に設けられて給電制御回路(110~116)の動作を 40 指示する制御情報を受信する受信回路(RFC106、 デジタルコンバータ回路108、又は受電端子部9aと データカプラ部102) とを設けるようにした。

【0012】さらに本願の請求項5に記載の発明は、べ ース構造体(定盤3)と、ベース構造体(3)で規定さ れる所定平面(XY平面)に沿って移動するステージ構 造体(可動ステージ本体2)と、ステージ構造体(2) 上で被処理基板(ウェハW等)を保持する基板載置部 (ホルダ10)とを有する移動ステージ装置(1)に適 用される。

【0013】そして本願発明では、被処理基板(W)を 基板載置部(10) に静電吸着させる静電吸着手段(電 極10a)と、ステージ構造体(2)に設けられた再充 \ 電可能なバッテリー (ニッカド・バッテリー100) と、ステージ構造体(2)に設けられてバッテリー(1 00)からの電気エネルギーを静電吸着手段(10a) に制御して供給する給電制御回路(CPU110, 高電 圧制御回路112)と、ステージ構造体(2)に設けら れて給電制御回路(110,112)の動作を指示する 制御情報を受信する受信回路(RFC106、デジタル コンバータ回路108、又は受電端子部9aとデータカ プラ部102) とを設けるようにした。

10

【0014】さらに本願の請求項10に記載の発明は、 ベース構造体(定盤3)上で移動可能なステージ構造体 (可動ステージ本体2)を予め記憶された制御プログラ ム (ミニコン52又は制御ユニットボード51内に記 憶) に従って移動させ、ステージ構造体(2)上に交換 可能に載置される複数枚の被処理基板 (ウェハW等) の 各々に回路パターンを転写することにより、被処理基板 (W) 上に回路デバイスを形成する製造方法に適用され

【0015】そして本願発明では、被処理基板(W)を ステージ構造体(2)上に吸着固定するための第1アク チュエータ (ホルダ10とその表面の電極10a)と被 処理基板をステージ構造体(2)上で3自由度以上で微 動させるための第2アクチュエータ(微動用のモータス M1, ZM2, ZM3) との少なくとも一方に電気エネ ルギーを供給する充電可能なバッテリー(ニッカド・バ ッテリー100等)と、そのバッテリー(100)を充 ト4 a ~4 d と永久磁石の組)と、被処理基板(W)を 30 電するための電気的な受端部(受電端子部9 a)とをス テージ構造体(2)に設け、ステージ構造体(2)が所 定のスタンバイ位置(ローディング位置等)に位置付け られると受端部 (9a) と接続されてバッテリー (10 0) への充電電流を出力する送端部(送電端子部9b) をベース構造体(3)に設け、バッテリー(100)の 充電のために、複数枚の被処理基板(₩)が処理される 間の適宜の時点でステージ構造体(2)をスタンパイ位 置へ移動させるコマンド又はパラメータ(ステップ55 A~55Gと57A~57G)を制御プログラムの一部 として登録できるようにした。

> 【0016】また本願の請求項14に記載の発明は、べ ース構造体(定盤3又はコラム30)と、ベース構造体 (3又は30)で規定される所定平面(XY平面)に沿 って移動するとともに、一部に被処理基板(ウェハW) を減圧吸着する載置面(ホルダー10)が形成されたス テージ構造体 (ステージ本体2) とを備えた移動ステー ジ装置に適用される。

【0017】そして本願発明では、ベース構造体(3又 は30)の一部に設けられてステージ構造体(2)の載 50 置面(10)に被処理基板を吸着するための負圧気体を

送り出す送端口(84)と、ステージ構造体(2)が所 定の待機位置(ローディング位置LDP)に移動したと きに送端口(84)と係合し得るようにステージ構造体 (2)の一部に設けられて、負圧気体をステージ構造体 (2)側に取入れる受端口(70)と、受端口(70) からステージ構造体の載置面(10)までの間に形成さ れる負圧気体の通路(70a, 73, 91;182, 1 80、91;160v,182、73、91)を開閉す る弁機構 (71又は71a) と、ステージ構造体 (2) が待機位置 (LDP) に移動して送端口 (84) と受端 10 口(70)とが係合している間は弁機構(71又は71 a)を開状態にし、送端口(84)と受端口(70)と が非係合の間は弁機構 (71又は71a)を閉状態にす る制御手段(51a, 71b, ステップ210, 22 2, 266) とを設けるようにした。

【0018】また本願の請求項20に記載の発明は、べ ース構造体(3又は30)と、ベース構造体(3又は3 0)で規定される所定平面(XY平面)に沿って移動す るとともに、一部に被処理基板(W)を減圧吸着する載 置面(ホルダー10)が形成されたステージ構造体

(2)とを備えた移動ステージ装置に適用される。そし て本願発明では、ベース構造体(3又は30)の一部に 設けられてステージ構造体(2)の載置面(10)に被 処理基板(W)を吸着するための負圧気体を送り出す送 出機構 (80~84, 51a) と、ステージ構造体

(2) が所定の待機位置(ローディング位置LDP)に 在るときに送出機構(80~84,51a)と係合し得 るようにステージ構造体(2)の一部に設けられ、送出 機構(80~84,51a)と係合中は送出機構からの 負圧気体をステージ構造体(2)の載置面(10)に導 30 · き、送出機構(80~84,51a)と非係合の間は外 気との流通が遮断される受入機構(70,71又は71 a;70,77)とを設けるようにした。

【0019】また本願の請求項25に記載の発明は、回 路パターンが形成されたマスク基板(R)を吸着保持し て走査区光の際に少なくとも1次元に移動可能な第1ス テージ構造体(26)と、回路パターンが露光される被 露光基板 (W)を吸着保持して走査露光の際に少なくと も1次元に移動可能な第2ステージ構造体(2)とを備 バターンの像を形成する方法に適用される。

【0020】そして本発明では、マスク基板(レチクル R)を第1ステージ構造体(レチクルステージ26)上 に所定時間に渡って継続的に吸着するのに必要なエネル ギー(静電吸着用の電気や真空吸着の減圧気体)が蓄積 される第1蓄積部材(バッテリーやタンク室)を第1ス テージ構造体(26) に搭載し、第1ステージ構造体 (26) がマスク基板(R)を交換するための待機位置 に位置したときは第1蓄積部材 (バッテリーやタンク

とし、第1ステージ構造体(26)が待機位置から離れ ている間は第1蓄積部材 (バッテリーやタンク室) から のエネルギーによってマスク基板 (R) の自立吸着を継 続させる段階と、被露光基板 (W) を第2ステージ構造 体(可動ステージ本体2)上に所定時間に渡って継続的 に吸着するのに必要なエネルギー(静電吸着用の電気や 真空吸着の滅圧気体)が蓄積される第2蓄積部材(バッ テリー100やタンク72,72a,72c)を第2ス テージ構造体(2)に搭載し、第2ステージ構造体

(2) が被露光基板 (W) を交換するための待機位置 (ウェハ交換位置LDP) に位置したときは第2蓄積部 材 (バッテリー100やタンク72, 72a, 72c) に新たなエネルギーを補充可能とし、第2ステージ構造 体(2)が待機位置(LDP)から離れている間は第2 蓄積部材(バッテリー100やタンク72、72a、7 2 c) からのエネルギーによって被露光基板 (♥) の自 立吸着を継続させる段階とを実行するようにした。

【0021】そして本願の請求項30に記載の発明は、 ベース構造体(3又は30)の上を移動するステージ構 20 造体(可動ステージ本体2)に被処理基板(W)を保持 し、ステージ構造体(2)の移動により被処理基板

(♥) 上に所望の回路バターンを露光するリソグラフィ 装置を用いて、被処理基板(W)上に回路デバイスを形 成する製造方法に適用される。

【0022】そして本願発明では、ベース構造体(3又 は30)上で規定される所定のローディング位置(ウェ ハ交換位置LDP) に向けて被処理基板 (W) を搬送す ると共に、ステージ構造体(2)をローディング位置 (LDP) に移動する段階 (ステップ204, 206, 212)と、ローディング位置(LDP)において被処 理基板(W)をステージ構造体(2)の基板載置部(ホ ルダー10)上に受け渡す段階(214)と、ステージ 構造体(2)がローディング位置(LDP)に在る間 は、ステージ構造体(2)内に形成される閉空間部(ホ ルダー10の溝91、上部ステージ体2aの吸着バッド 144、リフトピンPC1PC3の吸着孔、エアジャッ キ124)で必要な減圧気体または加圧気体をステージ 構造体(2)に設けられた受端□(70)を介して供給 する段階(例えばステップ210,216)と、ステー えた投影露光装置を用いて、被露光基板(W)上に回路 40 ジ構造体(2)がローディング位置(LDP)から離れ ている間は受端口(70)の外気との連通を遮断する段 階(例えばステップ222)とを実施するようにした。 [0023]

【発明の実施の形態】本発明は、可動ステージ本体に接 続されるチューブや配線のテンションによる影響を低減 するために、それらのチューブや配線の本数を極力少な くすることを基本的な考え方としている。そして最も望 ましい1つの態様においては、可動ステージ本体内に設 けられている真空作動源(ウェハ又はマスクを吸着する 室)に新たなエネルギー(電気や減圧気体)を補充可能 50 ホルダ等)や空力作動源(浮上用のエアペアリング等)

を電磁力や静電力による電気的作動源に置き換え、その 電気的作動源とともに可動ステージ本体の移動を司る電 気的作動源 (リニアモータのコイル等) を作動させる電 気エネルギーを、可動ステージ本体に搭載したバッテリ ーから駆動回路を介して供給するように構成し、その駆 動回路を電波通信や光通信による無線方式で制御するよ うに構成する。

【0024】また本発明の別の好適な態様においては、 可動ステージ本体内の真空作動源や空力作動源を電気的 作動源に置き換えることで、少なくとも真空供給用や圧 10 搾空気供給用のフレキシブルチューブが不要となり、同 時に可動ステージ本体にバッテリーと駆動回路を搭載す ることによって電力供給用の太いワイヤー線の東が不要 となる。このため駆動回路には細い通信用のケーブルだ けを接続すればよく、可動ステージ本体に加わるケーブ ルのテンションを小さくすることができる。

【0025】また本発明の別の態様によるステージ装置 では、真空供給用や圧搾空気供給用のフレキシブルチュ ーブのみを無くし、電気エネルギーの供給は従来通りの に搭載のバッテリーは消費電力の少ない静電力による吸 着作動源や小型モータへの給電に使われ、可動ステージ 本体をベース定盤上で移動させる大電力の電磁気アクチ ュエータ (リニアモータ、磁気浮上用コイル等) に対し ては従来通りの配線方式としてもよい。

【0026】 このように可動ステージ本体にバッテリー を搭載する場合、そのバッテリーは再充電可能なニッケ ル・カドミウム、ニッケル・水素等のバッテリーの他 に、大容量の電解コンデンサーでもよいが、いずれの場 合も適宜の時点で充電作業が必要となる。そこで本発明 30 によるステージ装置を露光装置に適用した場合は、ステ ージ装置上に基板を順次載置して露光処理する間の適宜 の時点で可動ステージ本体をスタンバイ位置に位置付 け、その位置でベース定盤又は装置コラム側の充電用送 電端子と可動ステージ本体側の充電用受電端子とを接続 させるようなバッテリー充電用のコマンド(ステージの 移動や停止、充電モードの指定等) やパラメータ (ステ ージの停止位置、充電時間等)を、露光装置制御用のブ ログラム内に登録できるような構成(ソフトウェア)に する必要がある。

【0027】そのスタンバイ位置は、好ましくはステー ジ装置上に基板を交換載置する際のローディング/アン ローディング位置、或いは可動ステージ本体の位置を計 測するレーザ干渉計をリセットするためのリセット位置 (ステージの物理的な原点位置)等のように、可動ステ ージ本体が比較的長い期間に渡って停止し得る位置に設 定される。

【0028】さらに、本発明の別の態様によるステージ 装置においては、ウェハやレチクル等の基板を真空吸着 するホルダーからステージ定盤または装置コラムに至る 50 板とホルダーとの間で生じるリークの有無、リークによ

真空吸着用の減圧気体のチューブを省略するために、定 盤や装置コラム側には減圧気体(真空圧)供給用の送端 口(アウトレット)を固定し、ホルダー上またはホルダ ーが搭載される可動ステージ本体上にはそのアウトレッ トと結合可能な受端口や受入機構(インレット)を設 け、可動ステージ本体が所定のスタンバイ位置(基板の 交換位置等) に停止するとアウトレットとインレットと の結合によりホルダーでの基板吸着が開始されるように 構成した。そして可動ステージ本体がスタンバイ位置か ら移動する場合は、そのインレットを介した吸着減圧路 の外気との連通を阻止するパッシブ又はアクティブな弁 機構を作動させて、ホルダーの基板吸着動作を持続する ように構成した。

【0029】とのようにして可動ステージ本体上に基板 を真空吸着する場合、ホルダー又は可動ステージ本体内 には、ホルダーの吸着面と連通し得る減圧予備室(リザ ーブタンクやタンク室)を設け、その吸着面における減 圧部(1ミリ程度の深さの吸着溝や微小な凹部)のみの 総体積が極めて小さいことによる吸着持続時間の極端な ワイヤー線で接続される。その場合、可動ステージ本体 20 低下を補い、長時間に渡って十分な真空吸着力が維持さ れるようにした。

> 【0030】また本発明による可動ステージ装置は、回 路バターンの描画されたマスクやレチクルを大きなスト ロークで1次元又は2次元移動するマスクステージ装置 にも同様に適用できる。特に、感応基板上の複数のショ ット領域をステップアンドスキャン方式で順次露光する ために、マスクやレチクルをそのサイズ以上のストロー クで走査移動させるマスクステージ装置に適用すると効 果的である。との場合も、マスクステージ装置は真空吸 着や静電吸着等によってマスクやレチクルを保持するた め、可動ステージ本体が引っ張っていく真空吸着用のフ レキシブルチューブや電気配線を省略できる、或は従来 よりも少ない本数のチューブや電気配線に制限できると いった利点は同様に得られる。

【0031】さらに本発明では、可動ステージ装置内で 必要な真空吸着機構だけでなく、加圧気体によって可動 体を移動させる空力駆動系に対しても同様なシステムが 構築でき、その場合は可動ステージ本体が空力駆動系に 必要な加圧気体を供給するためのフレキシブルチューブ 40 類を引っ張り回すことが避けられると言った利点があ る。との利点は、1つには可動ステージ本体内の空力駆

動源に接続される加圧気体の供給路中を開放/遮断する ための弁機構を可動ステージ本体に設けることによって 【0032】また本発明においては、可動ステージ本体

上の弁機構や滅圧予備室で構築される自立吸着システム によって基板がホルダー上に真空吸着されている間、そ の吸着力が正常に作用しているか否かを判断する吸着監 視プログラムを作動させるようにした。これによって基

る吸着力の変化、吸着持続時間の管理等が自動的に行わ れ、可動ステージ本体の加減速によって基板がホルダー 上で位置ずれを起し得るととが事前に予測可能となる。 このため、露光装置を用いたリソグラフィ工程が安全に 運用され、半導体素子や液晶表示素子等のデバイス製造 の歩留まりが向上する。そこで、以下に本発明の具体的 な実施例の幾つかを図面を参照して説明する。図1は本 発明の第1の実施例によるステージ装置1の全体構成を 示す斜視図であり、被処理基板としての半導体ウェハが 載置されるホルダー10の載置面には静電吸着用の電極 10 10aが形成されている。ホルダー10は可動ステージ 本体2上に設けられた不図示の2方向微動機構とレベリ ング機構(両者を合わせて2/L微動機構とする)とに よって支持されている。そして可動ステージ本体2は、 ベース定盤3上に形成された規定平面3 a に沿ったX、 Y方向に2次元移動可能に支持されている。

【0033】ことで図1のステージ装置1は、ステージ 本体2の自重を支持するフルフラットな平面3aを2方 向ガイド面として有するが、それ以外のX、Y方向の移 動ガイド面は持たないガイドレス方式で構成される。そ 20 のためステージ本体2の下部には、平面3aに対して磁 気浮上力を発生させる複数の電磁石ユニット(ととでは 不図示) の他に、ステージ本体2をX、Y、θ方向に運 動させるための推力を発生する複数のコイル等の電磁推 *進ユニット4a、4b、4c、4d(4dは不図示)が 設けられている。

【0034】との電磁推進ユニット4a~4dは、ベー ス定盤3の平面3a内のほぼ全面にマトリックス状に配 列された多数の永久磁石と協同して各方向の推力を発生 するように2次元移動タイプの平面モータとして構成さ 30 れている。とのような構造に類似したステージ装置は、 例えば米国特許第4.654.571号に開示されてお り、必要に応じてその公報に開示された構成をそのま ま、或いは若干の変形を加えて図1の装置に適用でき る。ただしその米国特許第4,654,571号では可 動ステージ本体のベース定盤に対する浮上をエアベアリ ング方式で行なっており、本実施例の図1のステージ装 置1の場合も可動ステージ本体2の下部にエアパッド部 を設けて同様のエアベアリング方式とすることができ る。

【0035】またステージ本体2、ホルダー10はセラ ミック材(髙絶縁性の非磁性体)で作られ、特にステー ジ本体2は軽量化を図るために内部をハニカム構造また はリム構造としてある。そしてステージ本体2のX方向 に延びた側端部には移動鏡5 Yが一体に形成され、Y方 向に延びた側端部には移動鏡5 Xが一体に形成され、各 移動鏡5 Y、5 Xの表面には夫々 X方向と Y方向とに延 びた反射面が蒸着されている。その移動鏡5Yにはベー ス定盤3に固定されたレーザ干渉計6 Yからの測長用ビ Y方向に関する座標位置の変化を表す干渉ビームがレシ ーバ7 Yによって光電検出される。

【0036】同様に移動鏡5Xにはレーザ干渉計6Xか らの測長用ビームがX方向に沿って投射され、移動鏡5 Xの反射面からの干渉ビームがレシーバ7 Xによって光 電検出される。そしてベース定盤3の側端部には送光用 のレーザビームを各干渉計5X、5Yに供給するビーム 路8 X、8 Yが形成される。さらに各干渉計6 X、6 Y はステージ本体2のX、Y方向の移動位置の計測だけで なく、ステージ本体2のΖ軸回りの回転量(θ方向のヨ ーイング)も計測するように構成され、これら干渉計6 X、6 Yで計測されたX、Y、 θ 方向の各計測値に基づ いて電磁推進ユニット4a~4dの各推力がサーボ制御

【0037】またとのステージ本体2の側端部の一部に は、内蔵されたバッテリーの充電のための受電端子部9 aが形成され、ベース定盤3上の対応した高さ位置には バッテリー充電用の送電端子部9bが台座9を介して取 り付けられ、そして台座9内には急速充電用の電源回路 が設けられている。さらに受電端子部9aと送電端子部 9 b には、ステージ本体2 に内蔵されたマイクロコンピ ュータと装置統括制御用の外部コンピュータとの間で各 種の情報通信を行う光カプラや電気カプラが設けられて いる。

【0038】ところで、図1のステージ装置がステップ アンドリピート方式またはステップアンドスキャン方式 の投影露光装置に適用される場合、紫外線(水銀ランプ の輝線やエキシマレーザ光等) 用の投影光学系や荷電粒 子線露光で使われる電子レンズ投影系等のパターン投射 系の位置と、ステージ本体2の位置とのXY方向の相対 的な位置関係を較正する必要があるので、ステージ本体 2の上面部の周辺には各種の基準マークを形成した基準 マーク板14が固定されている。

【0039】さらにステージ本体2の別の周辺部には、 バターン投射系の外側に配置された装置コラム側の送受 光部と光通信するための小レンズ体を含む光カプラ部1 2が取り付けられている。このような光カプラ部12の 具体的な構成と使い方に関しては、本願と同一出願人に よる先の出願、特願平8-229839号に詳細に開示 40 されているので、ととでは詳細な説明を省略する。次 に、図1のステージ装置の可動ステージ本体2に内蔵さ れる電気回路系の全体的な構成を図2を参照して説明す る。図2においてエネルギー蓄積部材としての再充電可 能なバッテリー100は、例えば7.5V、3600m Ahのニッケル系バッテリーの複数個を直列または並列 にしたものであり、必要な電力容量が確保されるように 構成される。バッテリー100からの電源ラインは、受 電端子部9aに接続される充電/通信カプラ回路102 と、ホルダー10の静電吸着用の電極10aに接続され ームが丫方向に沿って投射され、移動鏡5 Yの反射面の 50 る高電圧制御回路112と、電磁推進ユニット4 a~4

10

dの各々に取り付けられた複数の電磁コイル群XM1. XM2、YM1、YM2に駆動電流を供給するドライブ 回路114、116と、ホルダー10のZ/L駆動機構 に内蔵されたボイスコイル型、Eコア型の電磁アクチュ エータやピエゾ伸縮素子等による3つのモータZM1, ZM2、ZM3の各々に駆動信号を供給するドライブ回 路118とに夫々接続される。

【0040】ととろで、図2では可動ステージ本体2を ベース定盤3に対して磁気浮上させるための電磁コニッ トや、それらのユニットへの給電回路を省略してある が、当然のことながら磁気浮上用の電磁ユニットも必要 に応じてバッテリー100からの電気エネルギーを受け て駆動される。ただしこの場合、図2のステージ装置1 にはZ/L駆動機構(ZM1~ZM3)が設けられてい るので、可動ステージ本体2を磁気浮上させる精度はそ れ程高くなくてもよい。すなわち磁気浮上用の電磁ユニ ットは、バッテリー100から簡単な定電流駆動回路を 介して一定電流を供給するオープンループ制御で十分機 能する。また、そのような磁気浮上用の電磁ユニット は、ステージ本体2を静圧気体軸受を介して浮上させる 20 場合は全く不要である。

【0041】さて、図2において安定化電源回路(VR C) 104は、比較的に消費電力が少ない回路群に対し て充電/通信カプラ回路102からのバッテリー電圧を DC/DCコンバータ方式等で安定化した電源電圧(5 V、±15 V等) に変換して供給する。その安定化され た電源電圧は、無線方式でアンテナATを介して電波を 受信したり送信したりするためのRF回路106と、無 線電波で送受信される各種の情報をアナログとデジタル との間で相互変換するコンバータ回路108と、ステー 30 ジ本体2内の電気回路系を全体的に制御するマイクロコ ンピュータ(CPU) 110とに送られる。尚、アンテ ナATとRF回路106(又はコンバータ回路108も 含む) によって無線方式のトランスミッターが構成され

【0042】CPU110は、充電/通信カプラ回路1 02内の制御ロジック部や通信インターフェイス部と接 続され、充電状態の管理/制御と通信ボートの管理/制 御とを行う。なお充電/通信カプラ用回路102内のイ ンターフェイス部は必要に応じて光通信用回路(LE D、フォトダイオード、変調-復調回路等)で構成して もよい。この場合には、ステージ装置1側の送電端子部 9 b にも光通信インターフェイス用の発光素子、受光素 子が設けられる。

【0043】またCPU110は、無線方式で外部の統 括コンピュータと通信するための各種デジタル情報(コ マンド、パラメータ、データ等)をコンパータ回路10 8との間でやり取りする。さらにCPU110は、外部 コンピュータから送信されたコマンドやパラメータに応 答して、ウェハの吸着と開放とを制御する情報を高電圧 50 ハ交換時にオン・オフされるので、その位置で受電端子

制御回路112に出力し、各ドライブ回路114、11 6、118には制御用の情報をリアルタイムに出力す

18

【0044】図2のように、ステージ本体2のXYθ方 向の移動を司る電磁推進ユニット4a~4dとZ/L駆 動機構のモータ ZM1~ZM3とを内蔵バッテリー10 0の電力で駆動する場合、ドライブ回路114、11 6、118への指令値出力のサイクルタイムはmSオー ダ以下の高速性が要求されるので、CPU110はマル チプロセッサタイプでクロック周波数が数十MH2程度 のものが望ましい。

【0045】また電磁推進ユニット4a~4d(或いは 磁気浮上用の電磁ユニット)に対して従来通りにステー ジ本体2とベース定盤3との間で電気配線を接続する方 式 (ワイヤード方式) にする場合、図2中の電磁コイル 群XM1, XM2, YM1, YM2と各ドライブ回路1 14、116とが不要となるので、CPU110による リアルタイム制御は専ら乙/し微動機構のドライブ回路 118だけになり、CPU110を構成するプロセッサ の処理負荷が軽減される。またその場合、図2中で最も 消費電力の大きいドライブ回路114、116が省略さ れるのでバッテリー100の充電サイクルを長くできる といった利点もある。

【0046】さらに電磁推進ユニット4a~4d(及び 磁気浮上用の電磁ユニット)とZ/L微動機構用のモー タZM1~ZM3とをワイヤード方式で給電する場合 は、ウェハのホルダー10への吸着、或いはステージ本 体2内に設けられた別の静電吸着バッドのための高電圧 制御回路112と他の小電力回路系だけが内蔵バッテリ -100からの電力で作動される。このため、バッテリ ー100の消費電力はさらに小さくなり、バッテリーの 小型化、軽量化の促進によるステージ本体2の総重量の 低減も可能となる。

【0047】との場合、静電吸着用の各種電極(10a 等)では一般に殆ど電流を消費しないので、高電圧制御 回路112の消費電力はかなり小さくでき、同時に精密 な駆動制御が必要な電気的作動源(4a~4d, ZM1 ~2M3) も無いために、CPU110やコンバータ回 路108等を省略することも可能となる。そして場合に よっては、図2中の充電/通信カプラ回路102と高電 圧制御回路112のみを小容量のバッテリー100とと もにステージ本体2に設けることも可能である。この場 合、ホルダー10へのウェハ吸着のオン・オフは充電/ 通信カプラ回路102の通信用インターフェイス部を介 して受電端子部9a、送電端子部9bから指示される。 【0048】一般にウェハ吸着のオン・オフは、ウェハ 交換時にステージ本体2がローディング/アンローディ ング位置に停止しているときに行われ、またステージ本 体2内に設けられた他の静電吸着パッドも一般にはウェ

部9 a と送電端子部9 b とが接続されるようにしておけば何ら問題ない。次に図3を参照して図1、図2のステージ装置を用いた露光装置の一例を説明するが、ととではチューブや配線等の引きずりによる影響が問題となり得る64 M b i t クラス以上の半導体メモリデバイス(D-RAM)の製造に対応したステップアンドスキャン方式の投影露光装置を例示する。

【0049】図3の露光装置はエキシマレーザ光源20からのパルスレーザ光を露光用照明光として利用する。エキシマレーザ光源20は波長248nmのKrFエキ 10シマレーザ光、又は波長193nmのArFエキシマレーザ光をパルス発光するものであり、その波長幅は露光装置の投影光学系PLを構成する各種の光学素子の硝材に起因した色収差が許容範囲内になるように狭帯化されている。狭帯化すべき中心波長の絶対値や狭帯化幅(1pm~300pmの間)の値は操作パネル21上に表示されるとともに、必要に応じて操作パネル21から調整できるようになっている。また操作パネル21からはパルス発光のモード(代表的には自励発振、外部トリガー発振、メンテナンス用発振の3つのモード)が設定できる。

【0050】エキシマレーザ光源20からのエキシマレーザ光は遮光性の管22を介して露光装置のビーム受光系23に導かれる。ビーム受光系23内には、露光装置の照明光学系24の光軸に対してエキシマレーザ光が常に所定の位置関係になるように、エキシマレーザ光の照明光学系24への入射位置や入射角度を最適に調整する複数の可動反射鏡が設けられている。

【0051】このように、エキシマレーザを光源とする露光装置の一例は、特開昭57-198631号公報、特開平1-235289号公報、特開平2-135723号公報、特開平2-294013号公報等に開示され、エキシマレーザ光源をステップアンドスキャン露光に利用した露光装置の一例は、特開平2-229423号公報、特開平6-132195号公報、特開平7-142354号公報等に開示されている。従って本願の図3に示した露光装置においても、上記の各特許公報に開示された技術内容をそのまま、或いは部分的に変更して利用可能である。

【0052】さて照明光学系24内には、エキシマレーザ光を一様な強度分布の照明光にするためのフライアイレンズ系、走査露光時のレチクル照明光を矩形スリット状に制限するレチクルブラインド(照明視野絞り)、ブラインドの矩形スリット状の開口をレチクル上の回路バターン領域に結像する結像系(コンデンサーレンズを含む)等が設けられている。レチクルに照射される矩形スリット状の照明光は、図3中の投影光学系PLの円形投影視野の中央にX方向(非走査方向)に細長く延びるように設定され、その照明光のY方向(走査方向)の幅はほぼ一定に設定されている。

【0053】尚、レチクル上の回路パターン領域周辺の 遮光帯の幅を狭くしたり、レチクルの走査移動ストロークを極力短くしたい場合は、例えば特開平4-196513号公報に開示されているように走査露光中にレチクルブラインドの走査方向の幅を変化させる機構を設けるのが望ましい。さて、レチクルは図3中のレチクルステージ26上に吸着保持され、レチクルステージ26は走査露光のためにリニアモータ等によってレチクルベース定盤28上をY方向に大きなストロークで直線移動するとともに、X方向と母方向に関してもボイスコイルモータ(VCM)、ピエゾ素子等によって微小移動可能に設けられている。そしてレチクルベース定盤28は、投影光学系PLのフランジを固定する本体コラム定盤30から上方に立設された4本の支柱29の上に固定されている。

【0054】本体コラム定盤30は、本実施例では内部を空洞にした箱状に形成され、その空洞内には先の図1に示したステージ装置のベース定盤3が固定されている。図3においては、図1中の構成要素のうちの可動ステージ本体2、X方向用の干渉計6X、送電端子部9bの台座9のみを模式的に示してある。そして図3中の可動ステージ本体2は、ウェハ搬送ロボット40のアーム42の先端に支持されたウェハwを受け取るローディング位置(スタンバイ位置)、又は可動ステージ本体2のホルダー上のウェハをアーム42に受け渡すアンローディング位置(スタンバイ位置)に静止しているものとする。従って図1中に示した受電端子部9aと送電端子部9bは図3の状態では互いに係合している。

【0055】さらに本体コラム定盤30の4隅の各々には、装置全体を床から支持するための防振機能付のマウント台32が設けられている。そのマウント台32は装置全体の自重をエアシリンダを介して支えるとともに、装置全体の傾きと2方向への変位、及び装置全体のX、Y方向の変位とをアクティブに補正するアクチュエータを備えている。

【0056】ととろで、図3に示した露光装置本体の全体的な動作は、装置本体内の各構成部分(エキシマレーザ光源20、照明光学系24、レチクルステージ26、ウェハ用の可動ステージ本体2、搬送ロボット40等)の各々を個別に制御する複数のユニット制御ボード51、各制御ボード51を統括的に制御するミニコンピュータ52、そして操作パネル53とディスプレー54等を含む制御ラック50によって管理される。各制御ボード51内にはマイクロブロセッサ等のユニット側コンピュータが設けられ、これらのユニット側コンピュータがミニコンピュータ52と連携することによって複数枚のウェハの一連の露光処理が実行される。

【0057】その一連の露光処理の全体的なシーケンスはミニコンピュータ52内に予め記憶されたプロセスプ 50 ログラムによって管理される。プロセスプログラムはオ ベレータが作成した露光処理ファイル名のもとに、露光 すべきウェハに関する情報(処理枚数、ショットサイ ズ、ショット配列データ、アライメントマーク配置デー タ、アライメント条件等)、使用するレチクルに関する 情報(バターンの種別データ、各マークの配置データ、 回路パターン領域のサイズ等)、そして露光条件に関す る情報(露光量、フォーカスオフセット量、走査速度の オフセット量、投影倍率オフセット量、ディストーショ ン補正量、照明系のσ値設定、投影レンズ系のNA値設 定等)をパラメータ群のパッケージとして記憶するもの 10 等)を決定する。

【0058】ミニコンピュータ52は、実行指示された プロセスプログラムを解読してウェハの露光処理に必要 な各構成要素の動作を、対応するユニット側コンピュー タにコマンドとして次々に指令していく。このとき、各 ユニット側コンピュータは1つのコマンドを正常終了す ると、その旨のステータスをミニコンピュータ52に送 出し、これを受けたミニコンピュータ52はユニット側 コンピュータに対して次のコマンドを送る。

【0059】 このような一連の動作のなかで、ウェハ交 20. 出する。 換のコマンドがミニコンピュータ52から送出される と、可動ステージ本体2の制御コニットとウェハ搬送口 ボット40の制御ユニットとが協同して、可動ステージ 本体2とアーム42(ウェハW)とは図3のような位置 関係 (スタンバイ位置) に設定される。このとき、可動 ステージ本体2の制御ユニット内のマイクロコンピュー タ、或いはミニコンピュータ52に予め記憶されたバッ テリー充電制御用または通信用のコマンドとパラメータ に応答したプログラムが起動される。

ャートの一例を示す。本実施例では、先の図2中に示し たCPU110が充電/通信カプラ回路102と協同し てバッテリー100の充電状態 (フルチャーシ時からの 放電電流や放電時間等のデータ)を管理しているものと する。そして可動ステージ本体2がスタンバイ位置(ウ ェハ交換位置) に停止して受電端子部9 a と送電端子部 9 b とが接続されると、端子部9 a、9 b 内のデータカ プラ部も接続されるので、図4のプログラムを実行する ユニットコンピュータ或いはミニコンピュータ52と可 動ステージ本体2側のCPU110とがソフトフェア上 40 で通信可能になる。

【0061】もちろん図4のプログラムは、図2に示し た無線方式のトランスミッター(RFC106、デジタ ルコンバータ108)を介してユニットコンピュータ或 いはミニコンピュータ52と可動ステージ本体2側のC PUllOとがソフトフェア上で協調して実行すること も可能であり、有線か無線のどちらの通信方式を選択す るかは露光装置の構成に応じて任意に設定できる。

【0062】さて図4のプログラムは、ことでは説明上

0とが協調して実行するものとし、そのプログラムが開 始されると、ミニコンピュータ52はステップ55Aの 充電管理ルーチンを実行する。このルーチンにおいてミ ニコンピュータ52は、ステージ本体2のCPU110 からバッテリーの充電状態に関する情報をRFC106 を介して無線方式で読み込み、その情報に基づいてバッ テリー100の緊急充電の要、不要を判定するととも に、送電端子部9hに出力すべき充電用電圧の発生バラ メータ(波形、電圧、周波数、デューティ、充電時間

【0063】そして、ステップ55Bにおいて緊急充電 が必要であると判断されると、ミニコンピュータ5.2は ステップ550において露光装置内の全体に対して露光 動作の中断を宣言する。とれに応答して制御ユニット5 1内の複数のユニットコンピュータによる各ユニットの 関連動作が一時的に中断される。ただし、ミニコンピュ ータ52はウェハステージ制御ユニットに対しては、次 のステップ55Dにおいてステージ本体2を図3に示す ようなスタンバイ位置に移動させるためのコマンドを送

【0064】そのコマンドに応答してユニット側のコン ピュータは、そのコマンドを実行させるのに必要な各種 のサブコマンドとバラメータ群とを無線方式でステージ 本体2側のCPU110に送出する。これによってステ ージ本体2は図3のようなスタンバイ位置に移動し、送 電端子部9 b と受電端子部9 a とが接続され、それを認 識した充電/通信カプラ回路102は制御ユニット側と の有線方式による通信を再開する。

【0065】次にCPU110は、ステップ55Eにお 【0060】そとで、図4にそのプログラムのフローチ 30 いて、ベース定盤3に設けられて制御ユニット側でコン トロールされる充電器(図1又は3中の台座9内に設 置) に対して、先のステップ55Aで決定された充電用 の各種パラメータに従った充電動作を開始すべく無線方 式又は有線方式で指令を送る。これによって充電用の出 力電流が図2中の送電端子部9 b、受電端子部9 b、充 電/通信カプラ回路102を介してバッテリー100に 印加され、パラメータに従ったモードで充電が行われ

【0066】とのとき、少なくとも図2中の髙電圧制御 回路112は、ホルダー10上の露光処理中のウェハに 対する吸着力が電極 10 a の残留帯電荷によって持続さ れ得る場合は、バッテリー100からの給電を受けない ように遮断してもよい。そして次のステップ55Fで は、緊急充電の動作が正常に完了したか否かが判断さ れ、もし充電動作が設定されたバラメータ通りに実行さ れなかった場合はエラー終了となる。このエラー終了 は、例えばCPU110や制御ユニット側のコンピュー タによって決定され、ミニコンピュータ52に有線方式 や無線方式で送出され、ミニコンピュータ52は充電作 ' ミニコンピュータ52とステージ本体2側のCPU11 50 業に異常が生じたことをオペレータに知らせる警報を発

生する。

【0067】またステップ55Fで充電作業が正常に終 了したと判定されると、次のステップ55Gにおいて、 露光動作の再開処理が実行される。この再開処理はCP UllOや制御ユニット側のコンピュータによって判断 され、再開可能であることがミニコンピュータ52に有 線方式や無線方式で通報される。従ってその通報を受け たミニコンピュータ52は、露光装置内の各制御ユニッ トに対して露光動作中断状態から続きの動作を開始させ るようなコマンドを送出する。

23

【0068】一方、先のステップ55Bにおいて緊急充 電が不要であると判定された場合は、ステップ57Aに てミニコンピュータ52はウェハ交換の実行タイミング か否かを判断し、もしウェハ交換のタイミングではない と判定すと、図4のプログラムを正常終了する。またと とで、ウェハ交換のタイミングであると判定されると、 ミニコンピュータ52は次のステップ57B, 57Cを 実行する。そのステップ57B、57Cは実質的に先の ステップ55D, 55Eと同じである。

【0069】とうしてステージ本体2がスタンバイ位置 20 に停止し、バッテリー100の充電が開始されると、ミ ニコンピュータ52からのウェハ交換のコマンドを受け たCPU110は、高電圧制御回路112に対してホル ダー10上の露光済みウェハの静電吸着を解除するよう な動作を指示する。この吸着解除は、ウェハ内やホルダ -10の電極10aに蓄積する残留帯電荷を速やかに放 電させるものであり、髙電圧制御回路112は、電極1 0 a との接続を切り離して電極10 a をアースに接続す るようなスイッチング動作、或は帯電荷を瞬時に中和す るために電極10aに逆バイアス電圧を印加する動作を 30 実行する。

【0070】次のステップ57Eにおいて、ミニコンビ ュータ52はウェハ搬送ロボット40のアーム42がホ ルダー10上の露光済みウェハを取り外し、未露光のウ ェハをホルダー10上に搬送して載置するようなコマン ドをウェハ搬送制御ユニットに指令する。とれによって 露光済みウェハがホルダー10からアンローディングさ わ、代わりに未露光ウェハがホルダー10上にローディ ングされる。

50内の制御ユニット側で認識され、その情報を有線方 式(充電/通信カプラ回路102経由)又は無線方式 (RFC106、デジタルコンバータ108経由)で受 けたCPU110は、次のステップ57Fにおいて、未 **露光ウェハをホルダー10へ静電吸着するための指令を** 高電圧制御回路112に出力する。そしてCPU110 による吸着確認の後、CPUIIOはステップ57Gに おいて一連のウェハ交換動作が完了したことを表わす情 報を有線方式又は無線方式でミニコンピュータ52に報 告する。

【0072】その後は、先のステップ55F, 55Gと 同様に充電動作が正常に行われたかが判断され、露光動 作の再開(とこでは新たなウェハに対する露光動作の開 始)がミニコンピュータ52に通報される。以上のよう に、本実施例ではウェハ等の被露光基板、又は被処理基 板の交換作業の際にバッテリー100に対する充電が行 われるので、緊急に充電が行なわれる場合以外は、スル ープットの低下を抑えることができる。またバッテリー 100によって、可動ステージ本体2に搭載される電気 的駆動系(図2中のXM1~XM3, ZM1~ZM3 等) は駆動せず、専ら静電チャックのみを駆動する場合 は、バッテリー100、充電/通信カプラ回路102、 高電圧制御回路112のみを可動ステージ本体2に搭載 すればよく、軽量化が図られる。

24

【0073】さらにその場合、バッテリー100は高電 圧制御回路112に対してのみ給電すればよいので、1 枚の被露光基板または被処理基板が露光作業や加工作業 のためにホルダー10上に吸着され続ける平均時間によ っては、バッテリー100を大容量の電解コンデンサー にすることもできる。また本実施例のように、自立電源 としてのバッテリー(或はコンデンサー)を可動ステー ジ本体に搭載することによって、可動ステージ本体の各 部の温度変化をモニターする温度センサー、投影光学系 PLを通して照射される光(露光用照明光やレチクル上 のパターンの像光線)の強度を可動ステージ本体上で光 電検出する光センサー、図3中のマウント部32に設け られた防振用アクチュエータの制御のために可動ステー ジ本体に取り付けられる加速度センサー、或は被露光基 板の周辺の酸素濃度、オゾン濃度、不活性気体の状態等 をモニターするためにステージ本体に取り付けられるガ スセンサー等からの各種検出信号を増幅したり、所定の 信号処理を加えたりすることが可能となる。

【0074】さらにそれらのセンサーから得られる各種 の情報を収集して、蓄積する記憶媒体とCPU110等 をステージ本体に搭載すれば、ステージ本体側で生じる 各種の状況を自己分析して、それを改善するための操作 をミニコンピュータ52等に要求する自己診断システム を組み込むこともできる。尚、図1、図2に示したステ ージ装置は、特に真空吸着用のフレキシブルチューブを 【0071】未露光ウェハのローディング完了はラック 40 廃止するととを目的として、被露光基板の吸着を静電方 式にしたものである。そのため図1、2のステージ装置 は、図3のように大気中で被露光基板を露光する装置以 外に、真空中で露光を行う荷電粒子線(電子線)露光装 置や不活性気体(窒素ガスやヘリウムガス等)の雰囲気 中で被露光基板を波長200mm以下の紫外線や軟X線 (波長1A~300A程度)で露光する装置(SOR露 光装置)等に利用して効果的である。次に、本発明の第 2の実施例によるステージ装置の構成を図5、図6を参 照して説明する。図5のステージ装置は、先の図3に示 50 した投影露光装置に搭載されることを想定した構造とな

っており、図3及び図1中に示した装置構成と同一に機 能する構造部分には同じ符号又は記号を附してある。

【0075】ただし図5のステージ装置は、図1の装置 のようにガイドレス構造ではなく、H型に配置された3 つの直線駆動モータ (リニアモータ) と、装置定盤に固 定された直線固定ガイド部材と、この固定ガイド部材と 直交する方向に延びて固定ガイド部材に沿って移動可能 な可動ガイド部材と、との可動ガイド部材に案内されて 装置定盤を移動する可動ステージ本体とを有し、各ガイ ド面がいずれも静圧気体軸受によって非接触支持される 10 エアベアリングガイド方式として構成される。

【0076】とのような構造のステージ装置の一例は、 特開昭59-101835号公報、特開昭61-209 831号公報、或いは特開平1-188241号公報等 に開示されており、必要であればそれらの各特許公報に 開示された技術内容をそのまま、又は若干変更して利用 することができる。そして図5のステージ装置では、特 にステージ可動部に搭載されて真空吸着部やエアシリン ダのように所定の減圧状態や加圧状態が維持され得る閉 空間部(減圧路や加圧路)に装置固定部から接続される 20 配管チューブを皆無にする、もしくはその本数を低減す ることを特徴としている。

【0077】さて、図5において、露光装置本体(ステ ージ装置本体)は半導体回路素子の製造現場である工場 の床FDに4つのマウント台32を介して支持される。 マウント台32の上にはベース定盤3となる装置コラム 30が取り付けられ、その定盤3の上には可動ステージ 本体2の一部を構成する下側ステージ部2bがエアベア リングを形成する複数の静圧気体パッド62を介して2 次元移動可能に支持されている。との下側ステージ部2、30 bの内側中央部には、図5の紙面内の左右方向であるX 方向に移動する可動ガイド部材60が配置される。

【0078】この可動ガイド部材60は、図5の紙面と 垂直な方向(Y方向)に延びたガイド面を有し、静圧気 体バッド61を介してベース定盤3上に支持されてい る。そして可動ガイド部材60のガイド面は、下側ステ ージ2bの内側に設けられた複数の静圧気体バッドによ ってY方向に挟み込まれるように構成される。さらに可 動ガイド部材60には、下側ステージ部2bに固定され がX方向に設けられている。従って下側ステージ部2 b と可動ガイド部材60の間には、下側ステージ部2bを 可動ガイド部材60のガイド面に沿ってY方向に移動さ せるリニアモータが形成される。

【0079】一方、可動ガイド部材60は、ベース定盤 3上に固定された固定ガイド部材65のX方向に延びた ガイド面にエアベアリングを介して拘束され、固定ガイ ド部材65と平行にベース定盤3上に取り付けられたリ ニアモータ66によってX方向の推力を与えられる。と のため、リニアモータ66が駆動されると、可動ガイド 50 【0084】さらに本実施例のレーザ干渉計システム

部材60と共に下側ステージ部2bも一体となってX方 向に移動する。

26

【0080】さて、下側ステージ部2bの上には、3つ のモータZM1~ZM3(図5では代表してZM1のみ を示す)を含む2/L駆動機構を介して上側ステージ部 2 aが取り付けられ、その上にはウェハWを真空吸着す るホルダー10が設けられている。そのホルダー10の 載置表面には微小な突出部(高さ1ミリ程度)の複数個 が輪帯状、ドット状、或いは線状に形成され、ウェハW の裏面がそれらの突出部の先端面に密接すると、ウェハ Wとホルダー10の載置面との間には突出部の高さに相 当する薄い滅圧層(真空吸着用の閉空間部)が形成され てウェハ₩が真空吸着される。

【0081】 このような真空吸着用のホルダー10の一 例は、特開平1-319965号公報等に詳細に開示さ れているので、必要に応じてその特許公報に開示の技術 をそのまま、或いは若干変更して本実施例のホルダー 1 0に適用することができる。また、ウェハ₩を2方向と 傾斜方向(X軸回りの傾斜とY軸回りの傾斜)との3自 由度で微動させるZ/L駆動機構とその動作についは、 例えば特開昭55-134812号公報、米国特許第 4,084,903号、特開昭58-103136号公 報、特開昭62-274201号公報、特開平7-20 1699号公報等に詳細に開示されている。

【0082】とれらの公報に開示された乙/上駆動機構 は複数個の小型回転モータやピエゾ伸縮素子で駆動され るが、ボイスコイル型モータやEコア電磁石のように電 磁力による反発力や吸引力を直接微動の推力にする直動 型モータで駆動してもよい。いずれにしろ、本願におい ても上記の各特許公報に開示された乙/し駆動機構をそ のまま、或は部分的に変更して利用可能である。

【0083】ところで上側ステージ部2aの周辺部に は、図1で示した構造と同様の移動鏡5Xが固定されて いる。この移動鏡5Xは、上側ステージ部2aのX方向 の座標位置をレーザ干渉計6Xとレシーパ7Xによって 計測するために設けられたものであり、図5では省略し てあるがY方向の座標位置を計測するための移動鏡5Y も同様に設けられている。ただし本実施例では、上側ス テージ部2 aの全体がZ/L微動機構によって傾斜する たコイルユニット63と磁気的に結合する磁石トラック(40)ため、レーザ干渉計6Xは移動鏡5Xの反射面上の2方 向に異なる2ヶ所の各々に測長用のビームLBmを投射 するように構成され、レシーバ7 Xは移動鏡5 Xの反射 面のX-Z平面に対する傾き変化量(ピッチング)を計 測して、Z/L微動機構の駆動によるウェハWの横ずれ 量を計測するように構成される。従って、本実施例にお ける干渉計システム 6 X、 7 X (6 Y、 7 Y) は、上側 ステージ部2aのX方向、Y方向の座標位置、ヨーイン グ (θ 方向の微小回転)、ピッチング (XY平面に対す る微小傾斜)を計測することができる。

は、投影光学系PLの鏡筒下部に取り付けた固定鏡ML x に基準ビームLB r を投射し、その反射ビームと測長 ビームLBmの移動鏡5 X からの反射ビームとの干渉に よって測長を行う。投影光学系PLの鏡筒は、その光軸 A X が X Y 平面(ベース定盤3の規定平面)と垂直になるようにフランジ部FLgによって装置コラムに固定されている。

【0085】そして本実施例においては、ウェハWをホルダー10に真空吸着するための減圧気体(300~380mHg程度の真空圧)の供給を、下側ステージ部210aの周辺端に固定された受端口70を通して行う。この受端口70は、可動ステージ本体2(2a, 2b)がウェハ交換のためのローディング位置に移動させたとき、ベース定盤3又は装置コラム30側に固定された送端口84と係合するように配置されている。その受端口70から取り入れた減圧気体は、電気信号に応答して受端口70の大気への開放と遮断とを切り換える電磁弁ユニット71と、チューブ73とを介して上側ステージ部2aに送られ、その後上側ステージ部2aの内部を通ってホルダー10の裁置面に供給される。20

【0086】さらに、電磁弁ユニット31を通る減圧気体の流路の一部には、ウェハWの吸着動作中はチューブ73と連通するリザーブタンク72が設けられる。とのリザーブタンク72は、ホルダー10の載置面に形成される減圧層からチューブ73までの全減圧容積が極めて小さく、その容積だけではウェハWの長時間に渡る吸着動作が維持できないととを解決するために設けられている。その最大の原因は、ウェハ裏面のミクロンオーダの不整により極く僅かなリークが起るからである。

【0087】そのリークの時間当たりの流量は、ウェハ 30 裏面の不整の程度によって大きく変化するが、一般に熱処理を経たウェハほどリーク流量が多くなる傾向にある。通常、この種の露光装置の場合、ウェハWはレチクルの投影像に対して解像線幅の1/5程度(例えば±0.04μm)以下の精度でアライメントされた状態で露光される。そのアライメント精度は1枚のウェハの露光処理の間は維持されていなければならない。従って、ウェハWのアライメント動作(ウェハマークの位置検出動作)の開始からウェハ上の複数のショット領域の露光完了までの間、ホルダー10上のウェハWはそのアライ 40メント精度を劣化させる程に微動しないように、その吸着力が規定されている。

【0088】その吸着力は、ホルダー10の載置面に形成される複数の突出部の平面的な配置、その突出部のウェハ裏面との接触面積の割合等によっても変わるが、何よりも真空圧の変化が支配的である。そこで本実施例では、図5のようにリザーブタンク72を設けることにより、僅かなリークが生じてもウェハWの吸着力を長時間(少なくとも露光処理のためにウェハがホルダー10に載置されている間)に渡って所定の範囲内に維持される50

ようにした。

【0089】そのリザーブタンク72は、図5では下側ステージ部2bの一部に外付けされているが、下側ステージ部2b内に内蔵させてもよい。また電磁弁ユニット71には、リザーブタンク72内又はチューブ73内の圧力を検知する圧力センサ(バキュームセンサ)が設けられ、その検知情報は図3に示した制御ラック50内の制御ユニット51中のステージ制御用ボードに送られる

【0090】さらに電磁弁ユニット71内には、チューブ73を通してホルダー10の載置面に供給される減圧気体の流量を調整するためのスピコン(可変絞り)が設けられている。とのスピコンは、ウェハWがホルダー10上に安定に、且つ位置ずれなく確実に吸着されるように、吸着開始時に真空圧供給路を通る減圧気体の流量を制限するものである。

【0091】また、受端口70と係合する送端口84は、固定部材83によって装置コラム30又はベース定盤3の一部に取り付けられ、チューブ82を介して気体20供給ユニット81に接続される。この供給ユニット81には工場内の真空元圧源や圧搾ドライエア源からのチューブ80が接続されている。そして気体供給ユニット81内にもチューブ82を通して送端口84に減圧気体(真空圧)を送り出したり、遮断したりするための電磁弁が設けられている。次に図6を参照して、図5に示した装置構成のうち、ホルダー10、上側ステージ部2a、ウェハ吸着用の補助減圧機構(70~73)、及び気体供給ユニット81の各構成部分について詳細に説明する。

【0092】図6は、その構成を模式的に示した配管ブロック図であり、図5中の構成部材と同一のものには同じ符号をつけてある。まず、ホルダー10の表面には図6に示すように複数の微小突出部90が形成されている。その突出部90は、ことでは特開平1-319965号公報に開示されているように、複数の輪帯状の突出部として狭い間隔部分(凹部)91と広い間隔部分(凹部)92とが径方向に交互に形成されるように配列されている。そしてその狭い間隔部分91によって規定される環状の細い溝は真空吸着用の減圧部として構成され、広い間隔部分92によって規定される環状凹部は外気に開放されて吸着時には僅かに負圧となる領域として構成される。

【0093】さて、このような構造のホルダー10は上側ステージ部2a上に取り付けられるが、このときホルダー10上の吸着用の環状溝91の各々は、ホルダー10内に形成された減圧路93、ゴムや樹脂性のオーリングOSを介して図5中にも示したチューブ73に接続される。従って、チューブ73を介して減圧気体(真空圧)を供給すると、ホルダー10上の各環状溝91内が減圧されて、ウェハWの裏面が環状の突出部90の各表

面に密着して吸着固定される。このときウェハWは各突 出部90の表面によって規定される面精度(例えば±1 μm程度未満)に倣って平坦化矯正される。

【0094】チューブ73は、下側ステージ部2bに固 定された電磁弁ユニット71に接続されるが、その電磁 弁ユニット71内には、受端口70からの減圧気体を導 くパイプ70a、このパイプ70aの大気への開放と遮 断とを切り替える電磁弁71aと弁駆動部71b、この 電磁弁71aからの減圧気体の流量を調整するスピコン (絞り) 71cとその調整ツマミ71d、及びホルダー 10の環状溝91からチューブ73の間の減圧路の負圧 を検知してウェハの吸着力をモニターするための圧力セ ンサ71eが設けられている。そして、電磁弁71aと スピコン71cとの間の滅圧路には、リザーブタンク7 2と連通するパイプ71fが接続されている。

【0095】図6の場合、可動ステージ本体2(2a, 2b) はスタンバイ位置に停止しているときの状態を示 し、受端口70は、ベース定盤3(又は装置コラム3 0) 側に固定部材83を介して支持された送端口84と 係合している。ととで、受端口70を直径数ミリ程度の 20 金属バイブで構成した場合、送端口84はその金属パイ プが密着して貫通するような円形開口部を備えたドーナ ツ状に形成された弾性体で構成される。

【0096】送端口84の円形開口部は、図6に断面と して示すように外側の径が大きく内側になるほど径が小 さくなる円錐状に成形されている。このため受端口70 の金属パイプは、可動ステージ本体2をY方向に所定の 推力で微動させるととによって送端口84の開口部内に 確実に貫入する。尚、受端口70の金属バイブと送端口 ために高い粘性のオイル (グリース) を薄く塗布してお いてもよい。

【0097】さて、送端口84と固定部材83との間に は比較的に弾性力の大きいベローズ85が設けられ、送 端口84はそのベローズ85によって、受端口70の金 属パイプと送端口84との係合時に生じる相対位置ずれ を吸収するように僅かな範囲で首振り可能となってい る。一方、ベース定盤3(又は装置コラム30)側に固 定された気体供給ユニット81内には、チューブ82を 介して送端口84へ送り出す減圧気体(真空圧)の通過 40 定される。ここでウェハ交換可能な状態とは、交換用 と遮断を切り替える電磁弁81aとその駆動部81bと が設けられ、電磁弁81aはチューブ80を介して工場 内の真空元圧源に接続される。

【0098】以上の構成において、電磁弁81aの駆動 部81bと電磁弁71aの駆動部71bには、それぞれ 図3に示した制御ラック50内の制御ユニット51のう ちのウェハ搬送ユニットを制御するボード51aから信 号SV1、SV2が送られ、各電磁弁71a、81aは その信号SV1、SV2に応答して減圧路の開放、遮断 を切り替える。さらに、圧力センサ71eは検知した圧 50

力(負圧)に応じた信号Spを制御ボード51aに送 り、その制御ボード5 la内のコンピュータは信号Sp に基づいてウェハ吸着状態を監視するプログラムに従っ て所定の警告情報を生成する。

30

【0099】その警告情報は、第1にはウェハ吸着が全 く不能に陥った場合に安全のために露光装置の動作を緊 急停止する目的で使われ、第2にはウェハ吸着力の変化 を経時的に監視して、吸着不良が発生する直前に再度吸 着動作を実行するか、エラーとして露光動作を中断する かを判定する目的で使われる。そのような警告情報を作 る吸着監視プログラムについては後で詳述する。

【0100】さらに制御ボード51a内のコンピュータ は、GP-IB、光ファイバー、RS232C等のパラ レルバスやシリアルバスを介して上位のミニコン52と 下位の搬送ロボット40とに接続されている。ミニコン 52は、それらのバスを通してSECSの通信規約に準 拠した形態で「ウェハ搬送」、「ウェハ交換」、「待 機」、「初期化」等のグローバルコマンドを制御ボード 51aに出力する。制御ボード51a内のコンピュータ は、それらのグローバルコマンドを受けて、搬送ロボッ ト40等の搬送機構上の各部の具体的な動作を制御する 複数のサブコマンドやパラメータで構成される複数組の プログラムを実行する。次に、図7~9、図11の各フ ローチャートを参照して図5、図6の装置構成における ウェハ交換、ウェハ吸着の動作を含む主要な動作を説明 する。図7~9. 11の各フローチャートは、主にウェ ハ搬送ユニットの制御ボード51 a内のコンピュータに 記憶されたプログラムよるウェハ搬送、ウェハ交換の主 要な動作を示したものである。尚ここでは、1枚のウェ 84の開回部との各々には、結合時のリークを防止する 30 ハWが機械的にプリアライメントされた状態で、図3の ように搬送アーム42上に載置(真空吸着)されている ものとする。

> 【0101】さて図7のプログラムAは、ミニコン52 から「ウェハ交換」のグローバルコマンドが送られたと きに実行され、そこではホルダー10上に処理済ウェハ が無い場合に新たなウェハ(未処理ウェハ)をホルダー 10上に吸着するまでの主な動作が示されている。

> (ステップ200) ことでは、ウェハ搬送ユニットが物 理的、時間的にウェハ交換可能な状態にあるか否かが判 (ローディング用)のウェハが正常にプリアライメント されて準備できていること、可動ステージ本体2が露光 動作のためにシェアされていないことの2点が共に成立 している状態である。従ってととでウェハ交換が不能と 判断されると、プログラムAによるウェハ交換動作は見 送られて、プログラムB(図8)によるシステム・エラ ーの処理ルーチンが実行される。そしてことでウェハ交 換可能と判断されると、次のステップ202に進む。

> 【0102】(ステップ202)とこでは、図6中の電 磁弁ユニット71に設けられた圧力センサ71eからの

20

信号Spの値を読み込み、その値が大気圧に応じた値か否かが判定される。この判定は、可動ステージ本体2のホルダー10上にウェハが吸着されているか否かを調べるために実行される。そして、ホルダー10上にウェハがあるときはプログラムAの以降の動作が見送られてプログラムC(図9)によるウェハ交換ルーチンが実行され、ホルダー10上にウェハが無いときは次のステップ204が実行される。

31

【0103】(ステップ204) CCでは、ウェハ搬送ロボット40の搬送アーム42上の未処理ウェハをロー 10 ディング位置に移動させるようなアーム移動指令(A1)を出力する。これによって、未処理ウェハはホルダー10の表面よりも高い2位置を保ったまま、XY平面内のローディング位置に向けて移動する。

【0104】(ステップ206)とこでは、先のステップ204とほぼ同時に、可動ステージ本体2をローディング位置に向けて移動させるためのステージ移動指令(S1)を出力する。この移動指令(S1)に応答した可動ステージ2は、図5、6中の受端口70のパイブが送端口84の真正面に数ミリ程度の間隔で対向するような位置まで高速に移動してきて停止する。尚、その停止位置は、本実施例の場合は露光処理済みのウェハをホルダー10から取り外すためのアンローディング位置となっている。

【0105】(ステップ208) ととでは、先のステッ プ206と並行して、図6中に示したパイプ80に供給 される真空源の元圧を確認する。その元圧は、図6中に 図示されていない圧力ゲージの検出値を読み取ることで 確認できる。この確認は必ずしも必要ではないが、正常 でない元圧のもとでウェハをホルダー10上に載置して 30 しまう不都合を事前に避けることができる。ここでもし 真空源の元圧が所定の圧力範囲にない場合は、ウェハ吸 着動作だけでなく露光装置の稼働自体に重大な支障が生 じているか、これから生じることを意味するので、装置 の稼働環境に異常があることを報告するためのプログラ ムD (図8) が実行される。この場合、可動ステージ本 体2はローディング位置の近傍(本実施例ではアンロー ディング位置)で受端口70と送端口84とが僅かに離う れた位置に停止し、オペレータによるアシストの待ち状 態になる。

【0106】(ステップ210)ステップ208で真空源の元圧が正常と判定されると、制御ボード51aは電磁弁71aを開放するような信号SV2を駆動部71bに出力する。これに応答して電磁弁71aは図6に示すような開放状態に切り替わる。

(ステップ212) とこでは先のステップ212と同時 に、可動ステージ本体2を精密にローディング位置に位 置付けるための微動指令(S2)を出力する。この指令 (S2) に応答して、可動ステージ本体2は受端口70 の全屋パイプが送端口84の問口部に直進して係合する ように微動される。そして図6のように受端口70の金属バイブが送端口84の開口部と緊密に結合されると、図5に示したリニアモータ63、66は可動ステージ本体2をその位置に停止するように干渉計6X、6Yの位置情報に基づいてサーボ制御される。

【0107】(ステップ214) CCでは、先のステップ212と同時に、搬送ロボット40の搬送アーム42を降下させて未処理ウェハをホルダー10上に受け渡すための指令(A2)が出力される。これによって未処理ウェハはホルダー10の裁置面上に図6のように裁置され、搬送アーム42はホルダー10上の空間から退避する。

【0108】(ステップ216) ここでは、先のステップ214と並行して電磁弁81aを開放するための信号 SV1を駆動部81bに出力する。通常、ステップ214の動作は1~2秒程度で終了するが、その間に電磁弁81aが開放されて、真空元圧源からホルダー10の吸着溝91までの減圧路とリザーブタンク72とに真空圧が供給される。このとき、リザーブタンク72への真空流路中にはスピコンがないので、リザーブタンク72内は直ちに真空元圧源と同程度まで減圧される。

【0109】一方、ホルダー10の吸着溝91への真空流路中にはスピコン71cが設けられているので、ウェハの裏面がホルダー10の突出部90と接触して受端口70から溝91までの流路が閉空間になったとしても、吸着溝91が真空元圧源と同程度に減圧されるまでには若干の時間遅れ(1秒以内)が生じる。そこで次のステップ218において、その時間遅れを見込んだタイマー待ちが実行されるが、そのステップ218は必ずしも必要ではない。

【0110】(ステップ220) ここでは、圧力センサ71eからの信号Spを読み込んで、その値が真空吸着時にあるべき圧力範囲内か否かが判定される。一例として、真空元圧源の圧力が350mHg程度に設定されている場合、検出された圧力が元圧に対して例えば十数%以内(350~390mHg程度の範囲)であれば所定の吸着力が確保できたと判定して次のステップ222に進む。

【011·1】しかし、検出した信号Spが吸着を表す圧 40 力範囲から外れている場合は、閉空間となっているはず の真空減圧路に大きなリークが生じていることになる。 その最大の原因は、ウェハとホルダー10との間での微 粒子(ゴミ)の挟み込みやウェハ自体の変形によって、 ホルダー10上の一部の突出部90とウェハ裏面との間 に数μm以上の隙間が生じることである。との場合は、 そのウェハが吸着不良であると判定されて、ブログラム Aの以降の動作はキャンセルされて搬送動作からやり直 したり、オペレータによるアシストを要求したりするリ トライ用のプログラムEが実行される。

の金属バイブが送端口84の開口部に直進して係合する 50 【0112】その搬送リトライのプログラムEは、基本

的にはホルダー10上の未吸着のウェハをアーム42に よってプリアライメント機構までアンローディングし、 プリアライメント動作から再実行する操作であるが、本 実施例とは直接関係しないので、ここでは詳細な説明を 省略する。

(ステップ222) とこでは、2つの電磁弁71a,8 1 a を共に閉成するための信号SV1, SV2を夫々駆 動部71b、81bに出力する。とれによって可動ステ ージ本体2側の真空吸着路は外気から遮断された状態に 切り換えられ、ウェハは専らリザーブタンク72内の真 10 空圧によって自立的な吸着状態に維持される。しかしな がら、一般にウェハ裏面とホルダー10の突出部90の 接触面との間には、それらの面の顕微鏡的な表面粗さの ために 1 μm以下の隙間が部分的に生じ得る。 このた め、ゆっくりではあるがリークが進み、真空圧が落ちて くることになる。そこで本実施例では、リザーブタンク 72によるウェハ吸着力の持続能力を監視するプログラ ム(図12)が起動可能となっている。

【0113】(ステップ224) とこでは、そのような 吸着監視のプログラムを起動(on)するか否かが判定 20 され、起動させないときはプログラムAによる一連のウ ェハ交換、吸着動作が完了し、吸着監視を行うときは次 のステップ226に進む。 ここでの判定は実際は吸着監 視の設定忘れをチェックするためのものであり、装置メ ンテナンス等の特別な状況のもとで解除されていない限 り、通常は吸着監視のプログラムが自動的に起動される ととになっている。従って、ことで吸着監視のプログラ ムが起動状態になっていないと判定されると、そのこと がバスラインを介してミニコン52に報告され、その旨 の警報や表示がオペレータに通報される。尚、その露光 30 装置が通常の量産用露光モードに設定されている場合 は、無条件に吸着監視プログラムが起動されるようにし ておいてもよい。

【0114】(ステップ226) ことでは、吸着監視の プログラムの起動にあたって、リザーブタンク72によ る自立吸着が開始された直後の圧力センサ71 eからの 信号Spを読み込んで記憶するとともに、真空圧のリー ク時間 (吸着力の持続時間) 等をモニターするための計 時タイマーを起動させておく。その吸着監視プログラム 吸着の開始時に起動され、ホルダー10上のウェハが取 り外されるまで継続される。監視プログラムは、一定時 間毎、又は可動ステージ本体2の駆動に関する何らかの サブコマンドが与えられる度に信号Spの値と計時タイ マーのカウント時間とを読み込み、ホルダー10の吸着 力の変化を予測演算し、その結果に基づいて種々の警報 情報を作成する。

【0115】以上のステップ226によって、プログラ ムAによるウェハ搬送、吸着の動作が完了する。とのと してミニコン52に報告される。その後可動ステージ本 体2は、ウェハ上のマークを検出するウェハアライメン ト動作やウェハ上の各ショット領域に回路パターンを転 写する露光動作等のためにミニコン52から与えられる。 各種のグローバルコマンドに応答して、図3のように投 影光学系PLの下で2次元移動する。次に図8を参照し て、プログラムA中のステップ200、208で分岐す るプログラムBとプログラムDについて簡単に説明す る。プログラムBは図8中のステップ230~240で 構成され、プログラムDはステップ242,244,2 40で構成される。

【0116】プログラムBのステップ230では、ミニ コン52からのグローバルコマンドの受け付け時にウェ ハ交換不能になっている原因を知るために、ウェハ搬送 ユニット内の各部の動作ステータスを読み取って解析 し、その状況をまとめてミニコン52に報告する。その ステータスの解析結果から、ステップ232ではウェハ 交換不能の原因がウェハ搬送ユニット (ロボット40) 側にあるのか、可動ステージ本体2側にあるのかが判断 される。

【0117】その結果、ステージ本体2側の問題でウェ ハ交換不能である場合は、ステージ本体2が別のグロー バルコマンド (例えば露光コマンド) に応答して動作中 であるものと判定し、ステップ234において、ウェハ 交換のグローバルコマンドに応答しない旨の報告(コマ ンドの無視)をミニコン52に報告してからプログラム B (及びプログラムA)を不実行終了する。

【0118】一方、ステップ232でウェハ交換不能の 原因がウェハ搬送ユニット側にあると判定されると、ス テップ236では、解析したステータス情報に基づいて その原因がウェハ搬送ユニット内でのウェハ搬送の単純 な遅れによるもの(正常準備中)なのか、エラーによる ものなのかが判断される。ここで正常準備中であると判 定されると、装置としてはウェハが所定位置まで搬送さ れてくるのを待てばよいので、プログラムAの最初のス テップ200からの動作が再実行される。

【0119】またステップ236において、ウェハ搬送 ユニット内でエラーが生じていると判定されると、ステ ップ238ではそのエラーが回復可能なものか否かが判 (図12)は、リザーブタンク72によるウェハの自立 40 断され、回復可能なエラーの場合はウェハ撥送ユニット 内での自動復帰動作を待つために、プログラムAの最初 のステップ200からの動作が再実行される。そして、 ステップ238において回復不能なエラーであると判定 されると、ステップ240に進み、解析されたステータ スに応じたエラー内容がミニコン52に報告される。

【0120】とれに応答して図3中のディスプレー54 にはエラー発生が表示され、ウェハ搬送ユニットの動作 が停止されてオペレータへのアシスト要求 (警報)が出 力される。そして、ウェハ交換のグローバルコマンドに とは、1つのグローバルコマンドが正常終了したものと 50 対してエラー終了した旨の報告をミニコン52に送信し

てプログラムB(及びプログラムA)をエラー終了す る。

【0121】一方、プログラムDのステップ242で は、真空元圧源の異常により真空吸着が不能状態になっ ている場合を考慮して、ウェハ搬送ユニット内の動作ス テータスを解析し、その状況に応じた警告情報を作成す る。そして次のステップ244では、ウェハ搬送ユニッ ト内の各可動部を緊急停止させてウェハや装置の安全を 確保する。その後、先に説明したステップ240が実行 され、解析されたステータスに応じたエラー内容がミニ 10 移動軌跡と干渉しないような2位置、とこではアーム4 コン52に報告される。これに応答して図3中のディス プレー54にエラー発生が表示され、オペレータのアシ スト要求 (警報) が出力される。 そしてウェハ交換のグ ローバルコマンドをエラー終了する旨がミニコン52に 送られてプログラムB (及びプログラムA) をエラー終 了する。次に、図9を参照してプログラムCによるウェ ハ交換動作を説明するが、ことでは、可動ステージ本体 2のホルダー10上に載置された露光済ウェハと、搬送 ロボット40のアーム42上の未処理ウェハとを交換す ったが、搬送ロボット40はアーム42の他に、ウェハ 交換時にウェハを一時的に保持するウェイトアーム41 を備えている。そのウェイトアーム41とアーム42と △ は図10に示すように構成される。そとで図9のウェハ . 交換動作を説明する前に図10を参照して搬送ロボット 40の構成と動作を簡単に説明しておく。

【0122】図10は、搬送ロボット40をXY平面内 で見たものであり、アーム42は多間接方式の3つのア ーム42a、42b、42cで構成される。そしてウェ 動部40aで回転させることによってY方向に直線移動 するように構成される。さらに本実施例では、駆動部4 0 aがロボット40本体に対して Z方向(同図の紙面と 垂直方向)に上下動可能に構成され、アーム42aに吸 着されたウェハを乙方向に移動させることができるもの とする。

【0123】またロボット40の本体には、2方向に上 下動可能なウェイトアーム41が設けられている。との ウェイトアーム41は、アーム42aによるウェハのY 空吸着により一時的に保持することができる。そのウェ イトアーム41は、ウェハ搬送用のアーム42aよりも 高い乙位置から低い乙位置までの間で上下動する。

【0124】さて以上のような構成において、本実施例 では、アーム42 & 上にブリアライメントされて吸着さ れた未露光のウェハW'を可動ステージ本体2のホルダ -10ヘローディングする場合、アーム42aはウェハ W'の中心がローディング位置LDPにくるまでY方向 に移動される。また箆光済みのウェハW"をホルダー1 0から取り外す場合、可動ステージ本体2はウェハ♥*

の中心がアンローディング位置ULPにくるように位置 決めされる。

【0125】とのようにローディング位置しDPとアン ローディング位置ULPとをY方向にずらすのは、図6 の構成から明らかなようにアンロード時にホルダー10 からウェハWを持ち上げる際、ホルダー10の吸着溝9 1から受端口70までの減圧路を大気に開放させておく ためである。一方、空のウェイトアーム41は、搬送ア ーム42aのY方向の運動によるウェハW'又はW"の 2aよりも下の2位置に退避する。そしてウェイトアー ム41は、搬送中のウェハW'又はW"の中心がウェイ トアーム41のY方向の中心41cとほぼ一致した位置 に停止すると、上方に移動してアーム42aからウェハ を受け取る。その後、ウェハW'又はW"を吸着したウ エイトアーム41は、搬送アーム42aよりも高い2位 置まで退避する。

【0126】また、図10のような構成の搬送ロボット 40の手前には、未処理ウェハ♥'のオリフラやノッチ る作業が行われる。そのために、図3では示していなか 20 を一方向に揃えるように位置合わせするためのプリアラ イメント機構43が配置され、未処理ウェハ♥'は初め にとこで回転テーブル43a上に載置される。従って、 複数枚のウェハを順次露光処理する場合、アーム42a はホルダー10上の露光済みウェハ♥"をウェイトアー ム41上に受け渡し、その後アーム42aは回転テープ ル43a上の未露光ウェハW"を保持してローディング 位置LDPまで搬送する。それからアーム42aは、ウ ェイトアーム41上の露光済みウェハW"を所定のウェ ハ保管位置(ウェハカセット、インラインの搬送中継位 ハを吸着する先端のアーム42aは、アーム42cを駆 30 置等)まで搬送し、ウェハ保管位置から新たな未露光ウ ェハW'を受け取って回転テーブル43aまで搬送す る。以上の動作の繰り返しによって、半導体素子製造の ための多数枚のウェハの露光処理が実行される。次に、 図9を参照してプログラムCによるウェハ交換動作を説 明する。

【0127】(ステップ250)ととでは、ウェハ搬送 ユニットの制御ボード51a内に作られるステータス情 報を読み込み、その情報を解析する。ステータス情報と は、ウェハ搬送中のウェハ位置や各駆動部の動作状態等 方向の撤送路の一部に配置され、搬送途中のウェハを真 40 の変化、エラー発生の有無をリアルタイムに表すもので あり、32~255のビットバターン、或いは多数バイ トのデータテーブルで構成される。従って、制御ボード 51a内のCPUはこれらのビットパターンやデータテ ーブルの内容を読み込み、現時点でのウェハの搬送状況 を解析して搬送動作上の問題点の有無をまとめる。

> 【0128】(ステップ252) とこではステータス解 析の結果、可動ステージ本体2が露光処理等のために前 のグローバルコマンドに応答した動作にシェアされてい るか否かが判断される。 ととで、ステージ本体2が前の グローバルコマンドに応答した処理のために動作中であ

ると判定されると、ウェハ搬送ユニット側はそのステー ジ本体2の動作の終了を待てばよいので、図7に示した プログラムAのステップ200からの動作に戻り、ステ ージ本体2の動作が終了すると次のステップ254を実

37

【0129】(ステップ254) とこでは、ホルダー1 0上の露光済みウェハの中心を図10中のアンローディ ング位置ULPに位置付けるようにステージ本体2を移 動させる指令(S3)が出力される。このアンローディ ング位置ULPでは、図6に示した受端口70のパイプ 10 えられる。 が送端口84の開口部の正面から数ミリ程度離れたとと ろに位置する。そしてステージ本体2がアンローディン グ位置ULPに停止する前に、次のステップ256が実 行されて、先のステップ250と同様にステータス情報 の読み込みと解析とが実行される。

【0130】(ステップ258) とこでは、解析された ステータス情報に基づいて搬送アーム42(図10では 42a) 上に何らかのウェハが吸着されているか否かが 判断される。ととでもしアーム42上にウェハがあると 判定されると、それは未露光ウェハであるのでステップ 20 260が実行される。

【0131】(ステップ260) 先に図10で説明した 通り、ととではアーム42(42a)上の未露光ウェハ をウェイトアーム41上に受渡す動作が実行され、未露 光ウェハはアーム42の上方空間に一時的に退避する。 この動作はステップ256(ステータス情報の読込みと 解析)、ステップ258(判断)を繰り返し行いつつ実 行される。そしてアーム42が空になったと判断される と次のステップ262が実行される。

ィング位置ULPに停止している露光済みのウェハを受 け取るために、アーム42をアンローディング位置に対 応したXY方向の位置まで移動するような指令(A3) が出力される。

(ステップ264)とのステップでは、図6に示した電 磁弁ユニット71内の圧力センサ71eからの信号Sp が読み込まれ、その値が吸着状態を表しているか否かが 判断される。 これは、 露光済みウェハをホルダー10か ら受取る際の安全を確認するためであり、その時点でホ ルダー10によるウェハ吸着が不良となっていると、露 40 光済みウェハがホルダー10上で大きくずれていること が予想される。その場合、そのままアンローディングし てしまうと、そのウェハを搬送路近傍の装置部分に衝突 させることになる。そこで、このステップにおいて信号 Spが吸着状態を表していないと判定されると、プログ ラムD(エラー処理)の実行により緊急停止され、正常 な吸着状態であると判定されれば次のステップ266が 実行される。

【0133】(ステップ266)ととでは、図6中の駆

SV2を出力する。ステージ本体2がアンローディング 位置にある場合、受端口70のパイプは大気に開放され た位置にあるので、電磁弁71 a の開放によってホルダ -10の吸着溝91から受端口70までの真空減圧路 (閉空間部)とリザーブタンク72の内部空間とは大気 に開放される。この際、ホルダー10の吸着力はスピコ ン71cの作用で若干の時間遅れを伴って開放されるの で、次のステップ268ではその時間遅れを見込んだタ イマー (1秒以下) が実行されて、所定の待ち時間が与

【0134】(ステップ270)タイマーによる待ち時 間の経過後、再び信号Spの値が読み込まれ、その値が ほぼ大気圧になっているか否か(実効的な吸着力が失わ れているか否か)が判断される。そして、ととで大気圧 になっていない、或いはほぼ真空圧になっていると判定 されると、エラーが生じたものと判断してプログラムD (エラー処理) が実行され、正常に大気開放されている ときは次のステップ272が実行される。

【0135】 (ステップ272) ここでは、アーム42 (42a)がホルダー10上の露光済みウェハを受け取 るための移動指令が搬送ロボット40に出力され、その 後、アーム42がウェハカセット等の退出位置まで移動 するための移動指令が出力される。これによってアーム 42上の露光済みウェハが退出位置に受け渡され、アー ム42が空になると次のステップが実行される。

【0136】(ステップ274) CCでは、アーム42 がウェイトアーム41上に一時的に待機している未露光 ウェハを受け取るような動作が実行される。このときア ーム42aはウェイトアーム41の側方位置まで移動さ 【0132】(ステップ262)とこでは、アンローデ 30 れ、ウェイトアーム41が下方に移動することによって、 未露光ウェハはアーム42aに受け渡される。

> 【0137】 (ステップ276) とこでは、アーム42 上に正しく未露光ウェハが受け渡されたか否かを判断す るために、ステータス情報の読み込みと解析とが実行さ れる。

> (ステップ278) そして、解析したステータス情報に 基づいて未露光ウェハが正しくアーム42a上に載置さ れたことが判断されると、露光済みウェハが正常にアン ロードされたものとして、引き続き図7中のプログラム F(ステップ204からローディング処理)が実行され るととになる。またととで、解析したステータス情報に 不具合が生じアンロードが正常に行われなかったと判定 された場合は、図8のプログラムDによるエラー処理が 実行される。

【0-138】以上の図7~9のフローチャートによっ て、露光処理のための複数枚のウェハの搬送、交換、吸 着の各動作が継続的に実施され、半導体の製造現場にお いて、露光装置は重大なエラーが生じない限りほぼ無人 状態で24時間に渡って自動運転される。次に図11の 動部71bに対して電磁弁71aを開放するための信号 50 フローチャートを参照して、吸着監視プログラムGの一

例を説明する。とのプログラムGは、ウェハ搬送ユニッ トの制御ボード51a内のCPUによって割込み処理で 実行されるが、そのプログラムG自体の機能をハードウ ェアに置き換えても同様に実施できることは云うまでも ない。

39

【0139】先の図7のステップ226で説明したよう に、監視プログラムGはホルダー10上にウェハが吸着 された直後の信号Spの記憶と計時タイマーのゼロリセ ット(ゼロからの計時開始)とによって開始される。ま た監視プログラムGはタイマーモードとトリガーモード 10 のいずれかで実行されるかが予め設定されている。タイ マーモードでは、計時タイマーのカウント時間が例えば 0.2秒経過するごとに割込み信号が発生してプログラ ムGが実行される。

【0140】その割込み信号の発生間隔(監視間隔) は、ホルダー10に吸着すべきウェハの裏面のフラット ネスや微粒子の付着可能性に応じて、任意の長さに設定 可能である。例えばウェハ上に第1層の回路バターンを 転写する場合、そのウェハの裏面のフラットネスは極め て良好であるため、監視間隔は比較的に長い時間、例え 20 ば数秒程度に設定できる。とれに対して熱プロセスを経 たウェハは、フラットネスの悪化により真空吸着時のリ ークが大きくなるため、監視間隔は短く設定される。す なわち、露光処理すべきウェハが経てきたプロセスに応 じて監視間隔を変更することで、最適な吸着監視が可能 となる。

【0141】一方、トリガーモードでは、可動ステージ 本体2の駆動モータ(図5中のリニアモータ63.66 等) に対して駆動コマンドが与えられる毎、或はステー ジ本体2の移動が停止して駆動コマンドが終了する毎、 即ちステージ本体2の移動時の加速直後毎や減速直後毎 に、監視プログラムGを実行するための割込み信号が発 生される。 とのトリガーモードは、ステージ本体2に生 じる大きな加速度によってホルダー10上でウェハが微 動して吸着のリーク状況が大きく変化し得る場合に有用 である。

【0142】さて以上のような2つのモードのいずれか が設定されていると、いずれにしろ所定の時間毎に吸着 監視の割込み信号が発生する。その割込み信号に応答し て監視プログラムGは図11の各ステップを実行する。 (ステップ300) ととでは、図6に示した圧力センサ 71eからの信号Spと計時タイマーでカウントされる 時間Tpとが読み込まれ、それらの値が監視履歴メモリ 内に記憶、蓄積される。

【0143】(ステップ302)ととでは、読み込んだ 信号Spの値が所定の許容値E2よりも大きいか否かが 判断される。その許容値E2は、ホルダー10のウェハ 吸着力が著しく低下してステージ本体2の加減速時にウ ェハが位置ずれを起こすことがほぼ確実な値に設定され ている。本実施例では、吸着監視の判断基準として許容 50 と共に、そのことがディスプレー54やパトライトにて

値E1の他に、装置規格上で公称の吸着力が得られる範 囲の許容値E 1も設定されている。

【0144】その様子を図12を参照して簡単に説明す ると、真空元圧をEO(例えば350mmHg)とする と、公称の吸着力が確保される範囲は許容値E1(例え ば400mmHg)であり、吸着力が実質的に失われる範 囲は許容値E2(例えば600mmHg)である。従っ て、このような判断基準を使って信号Sp (減圧値)の 時間的な変化を計測することで、吸着力が安全範囲を越 えるまでに要する時間を容易に予測できる。

【0145】さてととで、信号Spが許容値E2よりも 大きい値であると判定されると、ウェハ吸着に重大な危 険性が生じたものとしてステップ304が実行され、許 容値E2以内であればステップ306が実行される。

(ステップ304) ことでは、装置運転上で吸着不良が 深刻になった旨をミニコン52に報告するためのレベル 1の警報情報を発生するとともに、そのことをディスプ レー54やパトライトにて表示する。その後、図8に示 したプログラムDが実行されて装置は緊急停止する。

【0146】(ステップ306)とこでは、監視履歴メ モリ内に蓄積された信号Spと時間Tpの各値に基づい て、吸着圧の最新の変化率APn (mmHg/sec.又はmm Hg/min.)が算出され、その演算結果が記憶される。 (ステップ308) ととでは、算出された吸着圧の変化 率△Pnに基づいて、吸着圧が許容値E1に達するまで の現時点からの予測時間Telと、許容値E2に達する までの現時点からの予測時間Te2とが計算され、その 値が記憶される。

【0147】(ステップ310)ととでは、ステップ3 00で読み取った信号Spの値が許容値E1よりも大き いか否か、即ちホルダー10上のウェハの吸着力が公称 範囲内に維持されているか否かが判断される。そして、 吸着力が公称範囲から外れている場合はステップ312 が実行され、公称範囲内である場合はステップ3 1 6 が 実行される。

【0148】(ステップ312) とこでは、吸着されて いるウェハに対する平均的な露光処理時間(厳密には現 時点からウェハ吸着動作が解除されるまでの平均的な残 り時間) TSと、ステップ308で算出された予測時間 Te2とを比較し、予測時間Te2が処理残り時間TS よりも小さいときはステップ314が実行される。また 予測時間Te2が処理残り時間TSよりも大きいはステ ップ328が実行される。

【0149】(ステップ314)とのステップでは、ウ ェハ上の全ショット領域の露光動作が終了してウェハを ホルダー10から取り外すまでの平均的な残り時間TS に対して吸着可能な予測時間Te2が短いことから、そ のまま露光処理を続けることが危険である旨をミニコン 52に報告するためのレベル2の警報情報が作成される 表示される。その後、図8に示したプログラムDが実行 されて装置は緊急停止する。

【0150】(ステップ316) ことでは、露光処理の ための平均的な残り時間TSに対して公称の吸着力を持 続し得る予測時間Telの方が長いか否かが判断され、 Te1≧TSのときは露光処理の間にウェハが安全に吸 着され続けるものと判定して、プログラムGによる割込 み処理を正常に終了する。またここで、Te1≥TSが 偽と判定されると次のステップ318が実行される。

【0151】(ステップ318) とのステップでは、ス 10 テージ本体2を一旦ローディング位置に戻してホルダー 10上のウェハを真空元圧によって再吸着するか否かが 判断される。このように、1枚のウェハを露光処理して いる間にウェハを再吸着することは、リソグラフィ工程 の精度上で見ると多少の問題を生じ得る。それは、再吸 着時にホルダー10上のウェハが微小な位置ずれを起 し、露光処理を再開した後のアライメント精度(重ね合 わせ精度)が大きく劣化し得ることである。そのため、 通常とのステップでは再吸着しないものと判定されてス テップ314 (レベル2の警報情報の発生、装置の緊急 20 停止)が実行される。

【0152】しかしながら、再吸着後にウェハ上のマー クを検出する精密なアライメント動作を実施してから露 光処理を再開する場合は、再吸着動作を実行しても何ら 不都合はない。従って再吸着の実行が指定されていると きは次のステップ320が実行される。

(ステップ320) とのステップでは、露光処理中の1 枚のウェハに対して設定されている再吸着の回数がm回 か否かが判断される。この回数mは通常は1であるが、 オペレータの指示によってそれ以上の回数に設定可能で 30 れた過去の吸着圧の変化率ΔPnのデータを呼び出し、 ある。従って、mが1に設定されている場合、それ以前 に再吸着動作が1度行われていれば、ここではm=1を 真と判定してステップ314(レベル2の警報情報の発 生、装置の緊急停止)が実行される。しかしながら、初 めて再吸着動作を行う場合は次のステップ322が実行 される。

【0153】(ステップ322)とこでは、ウェハの再 吸着動作を行うことによってウェハの位置ずれが発生し 得る旨を表すレベル3の警報情報が作成される。とのレ ベル3の警報情報は、ミニコン52に報告されて露光動 40 作の中断が指示されると共に、ディスプレー54に表示 され、場合によってはエラーログのデータベースに記憶 される。このとき、露光動作の中断は、その時点で処理 中のショット領域に対する露光が終了して、次に露光す べきショット領域のマップ位置が記憶された時点で実行 される。

【0154】(ステップ324)とのステップでは、先 の図7のプログラムAで説明したように、ステージ本体 2をローディング位置LDP(図10参照)に位置付け し、受端口70のパイプと送端口83の開口部とを結合 50 け、その2つのコンパレータの各々から出力される2値

させた後、信号SV1, SV2を出力して電磁弁81 a. 71aの順番で開放する。この順番が逆だと、ホル ダー10内の真空減圧路が瞬間的に大きなリーク状態に なって、ウェハの位置ずれが助長されることがある。そ の後、圧力センサ71eからの信号Spを確認して電磁 弁71a、81aを閉じると共に、ミニコン52に再吸 着完了を報告する。 これに応答してミニコン52は露光 処理 (アライメント動作) を再開して、記憶しておいた 次のショット領域からの露光動作を開始する。

【0155】(ステップ326)とこでは先の図7に示 したステップ226と同様に、信号Spの値が初期値と して監視履歴メモリに記憶され、計時タイマーのカウン ト時間がゼロリセットされる。これによってプログラム Gの割込み処理は終了する。ところで、先のステップ3 12においてTie2≥TSが真と判定された場合、それ はウェハ吸着が公称の吸着力ではないが、露光処理の残 り時間TSの終了までは一応持続されることを意味す る。そのため、ウェハの位置ずれ発生の不安が残ること から、次のステップ328が実行される。

【0156】(ステップ328)ととでは、先のステッ ブ318と同様に再吸着するか否かが判断される。しか しながら、ことに至るような状況下での再吸着動作はス テップ318の場合ほど必要性が高い訳ではなく、無視 してして次のステップ330に進んでもよい。ところ が、Te2≧TSが真であっても、露光処理残り時間T Sの絶対値が大きいときは露光処理の最後辺りのショッ ト露光の際に、予測時間Te2の誤差によって再吸着を 余儀なくされるとともある。

【0157】そとでととでは、監視履歴メモリに蓄積さ それらの移動平均、関数近似等の計算を行ってデータ上 で詳細な予測検定を行い、その結果から再吸着の要、不 要を判定する。従ってととで再吸着が必要と判定された ときは、先のステップ322からの動作が実行され、再 吸着が不要と判定されたときは次のステップ330が実 行される。

【0158】(ステップ330)とのステップでは、ウ ェハ吸着力が低下する不安はあるものの、露光処理の完 了までは一応の吸着が維持される旨を表すレベル4の警 報情報が生成され、その情報がミニコン52に報告され て、プログラムGの割込み処理が終了する。以上のよう にして監視プログラムGの一連の動作が完了するが、本 実施例ではとの監視プログラムによって4レベルの警報 が生成される。その警報は、レベルが小さいほど深刻な エラーであり、レベルが大きいほど軽度なエラーとみな される。また先に述べたように、監視プログラムGの機 能は簡単なハードウェアによって構成可能であり、例え ば信号Spのアナログ電圧を許容値E1, E2の各々に 対応した基準電圧と比較する2つのコンパレータを設

信号を適当なロジック回路にてデジタル演算して、ウェ ハ吸着力の変化に応じた各種の警報情報を発生させると とができる。次に、本発明の第3の実施例によるステー ジ装置の構成を図13を参照して説明する。図13は、 先の図5.6に示した装置コラム30側の気体供給制御 系81の変形実施例を示すものである。そして本実施例 では、ホルダー10上に吸着されたウェハ♥を取り外す 際、ステージ本体2側の電磁弁71aを開放して受端口 70を単に外気に連通させるだけでなく、ウェハWをホ ルダー10の表面から積極的に微小量(数 µm以下程 度) だけ瞬間的に浮上させ得るような構成を設けたこと に大きな特徴がある。

【0159】図13において、先の図6中に示した構成 部材と同一のもの、電磁弁81a, 駆動部81b, 信号 SV1, チューブ82, 固定部材83, 送端口84, ベ ローズ85には同じ符号をつけてある。そして、真空吸 着用の減圧気体供給源からの真空元圧は、チューブ80 a、電磁弁81a、スピコン87a、チューブ89a、 流路切り換え用の電磁弁95、及びチューブ82を介し て送端□84に導かれる。同様に、ウェハ♥を瞬間的に 20 浮上させるための圧搾気体供給源からの加圧気体は、チ ューブ80b、電磁弁86a、スピコン88a、チュー ブ89 b、流路切り換え用の電磁弁95、及びチューブ 82を介して送端口84に導かれる。

【0160】電磁弁86aは駆動部86bへの信号SV 4 に応答して流路の開放と遮断とが切り換えられ、スピ コン87a、88aは夫々つまみ87b、88bの調整 によって各気体の流量を調整する。そして電磁弁95に は、切り換え用の信号SV3に応答してピストン95a aが接続される入力ポート95c、加圧気体用のチュー ブ89bが接続される入力ポート95d、及び送端口8 4に気体を導くためのチューブ82が接続される出力ポ ート95gが設けられている。

【0161】との電磁弁95のピストン95aは全体と して円柱状に成型され、その中央部には特殊な窪み95 e、95fが形成されている。窪み95e、95fはピ ストン95aの円周表面に沿って所定の深さで切削さ れ、窪み95eのピストンの移動方向に関する幅は2つ の入力ポート95 c、95 dの間隔よりも小さく設定さ 40 れ、窪み95fのピストンの移動方向に関する幅はピス トン95aの移動範囲内で常に出力ポート95gと対向 するように設定されている。

【0162】従って図13に示したピストン95aの位 置では、入力ポート95cがピストン95aの先端部で 密閉され、入力ボート95 dからの加圧気体が窪み95 e、95fを通って出力ポート95gに導かれ、ステー ジ本体2側の受端口70には送端口84を介して加圧気 体が供給される。またピストン95aが図示の位置から 右方向に切り換えられると、入力ポート95dがピスト 50 【0168】その直後、電磁弁7laが信号SV2に応

ン95 a の後端部で密閉され、入力ポート95 c からの 減圧気体が窪み95e、95fを通って出力ポート95 gに導かれ、ステージ本体2側の受端口70には送端口 84を介して真空圧が供給される。

【0163】以上の構成において、スピコン87a、8 8 a は特に設けなくてもよいが、ホルダー10 によるウ ェハWの最適な吸着動作と、吸着解除時のウェハWの最 適な浮上量とを微妙に調整するためには設けた方がよ い。そして本実施例の場合、電磁弁81aの開閉を制御 する信号SV1、電磁弁86aの開閉を制御する信号S V4、電磁弁95の切り換えを制御する信号SV3、及 び図6に示したステージ本体2側の電磁弁71aの開閉 を制御する信号SV2のそれぞれを的確なタイミングで 与えることで、ホルダー10からのウェハ♥の取り外し がよりスムーズに実現できる。

【0164】次に図13の構成の気体供給システム81 を図5の投影露光装置と組合わせた場合の動作を説明す る。本実施例の場合も、ウェハ搬送やウェハ交換の各動 作は基本的には図7~9に示したフローチャートと同様 であるが、本実施例では図10のようにウェハのローデ ィング位置LDPとアンローディング位置ULPとをず らしておく必要がなく、一致させることができるといっ た利点がある。そとで以下においては、特にウェハのホ ルダー10への吸着動作と吸着解除動作とに関連した部 分について、図14のタイムチャートを参照して説明す

【0165】図14(A)に示すように露光装置の全体 シーケンスにおいては、先行するウェハの露光動作の終 了後、ウェハ交換作業を実行し、新たなウェハの露光動 を往復移動する駆動部95b、真空圧用のチューブ89 30 作を開始するものとする。この図14(A)のシーケン スタイミングに対応して、図14(B)はステージ本体 2の移動シーケンスを示し、図14(C)、(D)、

(E) はそれぞれ電磁弁71a、81a、86aの各開 閉シーケンスを示し、そして図14(F)は電磁弁95 の切り換えシーケンスを示す。

【0166】まず、先行するウェハの露光動作が完了 (最後のショット領域に対する露光が完了) するまで、 電磁弁71a、81a、86aはいずれも流路を閉じた 状態に設定され、電磁弁95は加圧気体側のチューブ8 9aを送端口84に連通させるべく、図13に示した通 りピストン95aが左側に位置(加圧側開放)するよう に設定されている。

【0167】さて、全体シーケンスにおいて先行するウ ェハの露光動作が完了すると、ミニコン52からウェハ 交換のグローバルコマンドが送出される。これに応答し てステージ本体2は、ローディング位置の近傍に向けて 高速移動し、受端口70と送端口84とが数ミリの間隔 で対向したら受端口70のバイブが送端口84の開口部 に貫入するように微動してから停止する。

答して開放状態に切り換えられ、搬送ロボット40によ る露光済みウェハのアンローディングが開始される。と のアンローディング動作においては、ホルダー10から 露光済みウェハを取り外すタイミングで電磁弁86 aが 信号SV4 に応答して所定時間だけ開放されて、図6中 のリザーブタンク72~吸着溝91内には加圧気体が瞬 時に導かれる。これによってホルダー10の載置面と露 光済みウェハとの間の吸着力が急激に消失し、ウェハは 吸着溝91から噴出される加圧気体によって載置面から 僅か (例えば数μπ程度) に浮上される。このため、搬 10 送口ボット40の搬送アーム42はホルダー10上の露 光済みウェハを極めてスムースに受け取ることができ

45

【0169】ただし、ホルダー10の載置面からの加圧 気体の噴出は、あまり強すぎるとウェハがホルダー10 上で踊ってしまうため、最適な状態になるように図13 中のスピコン88aで流量調整をしておく。とうして露 光済みウェハがホルダー10の載置面上からアンローデ ィングされると、電磁弁86aは閉じ状態に戻され、吸 着溝91からリザーブタンク72までの空間は大気に開 20 放された状態になる。その後、未露光ウェハがホルダー 10の上方空間にローディングされてくると、適当なタ イミングで電磁弁95が信号SV3に応答して真空側を 開放する(ビストン95aが右位置になる)ように切り 換えられ、未露光ウェハの裏面がホルダー10の載置面 に受け渡される直前に電磁弁81aが開放状態に切り換 えられる。

【0170】これによって、リザーブタンク72から吸 着溝91までの閉空間部(減圧路)には真空元圧源から の減圧気体が供給され、未露光ウェハはホルダー10表 30 面の突出部90に真空吸着される。そして電磁弁71 a、81aが共に開放している間に、圧力センサ71e からの信号Spを読み込む吸着確認動作が開始され、そ の値が真空元圧に近い値になっているか否かが判定され る。このとき信号Spの値が真空元圧に近ければ、重大 なリークがないと判断して電磁弁71 aを閉じ状態に切 り換えて、その直後に再び吸着確認動作を実行して真空 圧が急激に悪化していくか否かを判定する。

【0171】その結果、真空圧の急激な悪化がない場合 圧側に開放するように切り換える。その電磁弁8 1 a の 閉じ状態への切り換えによってウェハ交換の全てのシー ケンスが完了し、ステージ本体2は露光動作のためにロ ーディング位置から移動を開始する。以上の通り、本実 施例ではローディング位置LDPとアンローディング位 置ULPとを同一位置にすることができるだけでなく、 ウェハをホルダー10から取り外す際に加圧気体による 浮上操作を加えるため、その取り外しの直前までウェハ をホルダー上に吸着保持することができ、ウェハの搬送 アーム等への受け渡し時の位置ずれが小さく抑えられ、

より安定なウェハ搬送が可能となる。次に、本発明の第 4の実施例による装置構成について図15を参照して説 明する。本実施例は、先の図5、6に示したリザーブタ ンク72の機能をウェハホルダー10の内部に設けた点 に特徴がある。図15は、ステージ本体2に設けられた ホルダー10の部分断面とベース定盤3(又は装置コラ ム30)側の送端口84付近とを示し、先の図5、6又 は図13で用いた構成部材と同一機能の部材には同じ符 号を付けてある。

【0172】図15において、ホルダー10の表面には 図6に示したように、複数の突出部90によって囲まれ、 た複数の吸着溝91が離散的に形成され、各吸着溝91 はホルダー10の内部に形成された通気路93で連通し ている。さらにホルダー10の内部には、複数個の球形 または円筒状のタンク室72aが通気路72bで連通し て設けられている。この複数個のタンク室72aは図 5、6で説明したリザーブタンク72と同様に機能し、 そのタンク室72aの一部は通気路93と連通され、ウ ェハWの裏面と突出部90の表面との間で生じる僅かな リーク分を補って吸着持続時間を拡大する。

【0173】 このホルダー10はステージ本体2の上部 に取り付けられ、タンク室72aをつなぐ通気路72b はホルダー10の側部でチューブ73で接続され、その チューブ73の他端はステージ本体2上に設けられた電 磁弁71aに接続される。との電磁弁71aは、ステー ジ本体2の側端部に形成された受端口70とチューブ7 3との間の通路を開閉するものであり、その開閉動作の ための信号SV2は受端口70の近傍に形成された受電 端子部71kを介してベース定盤3(又は装置コラム3 0)側の送電端子部84kから供給される。

【0174】さらに、ホルダー10内には通気路72b に接続された圧力センサ(半導体圧力センサ)71eが 設けられ、そのセンサ71eからの検出信号Spはステ ージ本体2に設けられた無線式トランスミッター(図2 中のRFC106とデジタルコンパータ108等から成 る送信機) によってアンテナATを介して電波として送 信される。

【0175】一方、ベース定盤3(又は装置コラム3 0)側の固定部材83にはベローズを介して送端口84 は電磁弁81aを閉じ状態に切り換え、電磁弁95を加 40 が設けられ、この送端口84の下部には信号SV2を送 るための送電端子部84kが所定の付勢力を伴って伸縮 可能に設けられている。そして本実施例の場合も、送端 口84には受端口70のパイプが密着嵌入する開口部が 形成され、その送端口84には図13に示した気体供給 系81が接続され、真空吸着用の減圧気体と吸着解除用 の加圧気体とが切り換えて供給される。

> 【0176】以上の構成において、一般にホルダー10 はアルミニウム製、セラミック製であり、またその厚み もそれ程大きくない。そのため、ホルダー10の内部に 50 タンク室72aを形成する場合、その立体形状はホルダ

-10に変形を与え難い球形、或いは円筒を基本構造と して造形するのがよい。このようにすると、タンク室7 2a内が減圧された場合のホルダー10の変形を最小に することができ、特にホルダー10の吸着面(複数の突 出部90の表面で規定される面)のフラットネスを悪化 させることがないと言った利点である。

【0177】尚、タンク室72aは図15のように複数 個を設けて通気路72bで連通することが望ましいが、 単一のタンク室であってもよい。また複数個のタンク室 72aを設ける際は、ホルダー10の内部にほぼ均等な 10 間隔で離散的に配列するのがよく、一例としてはホルダ -10の中心から等距離の半径上で周方向に一定間隔で 複数個を設けるのがよい。

【0178】また以上の構成においては、先の図13の 気体供給系81によってホルダー10上の露光済ウェハ の吸着解除と未露光ウェハの吸着とが行われるため、ス テージ本体2は、図14に示したようにウェハ交換作業 中はローディング位置に停止していればよい。従って、 ウェハ交換作業の間、電磁弁71aの開閉用の信号SV 2をやり取りする受電端子部71kと送電端子部84k 20 とは常に接続状態となっており、図14の動作がそのま ま実行可能である。

【0179】さらに、本実施例では図15には示してい ないが、図2のようなバッテリー100が無線式トラン スミッター(106, 108)の電源としてステージ本 体2 に搭載され得る。との場合、トランスミッター(1 06、108)の消費電力は極めて小さいため、バッテ リー100は小型のものが選択できる。この構成によっ て、圧力センサ71eからの信号Spをステージ本体2 から制御ラック50(図3参照)まで導く電気配線が省 30 略される。ころしてトランスミッター(106, 10 8) から送信される電波は制御ラック50内のレシーバ ーで受信されて元のアナログ信号Spに変換され、ウェ ハ交換プログラムA〜吸着監視プログラムG等で使われ

【0180】以上の通り本実施例では、ホルダー10内 にウェハ吸着の長時間化を図るためのタンク室72aを 形成し、そのタンク室によって減圧吸着用の閉空間部の 実効的な容積(体積)を拡大するため、かなり長時間に 本実施例では、ホルダー10内にタンク室72aといっ た空間が形成されるので、ホルダー10自体を10~3 0%程度軽量化することが可能となる。次に、図16を 参照して本発明の第5の実施例による装置構成を説明す る。本実施例もウェハホルダー10によるウェハWの真 空吸着装置に関するものであり、先の図15の構成に対 して若干の変形を加えたものである。図16が図15と 異なる点は、ホルダー10内に形成していたタンク室 を、ステージ本体2を構成するセラミックス製のブロッ ク内に設けたことである。

【0181】図16において、ホルダー10の基本構成 は図6と同様であり、ホルダー10の複数の吸着溝(減 圧凹部) 91はホルダー10内に形成された通気路93 によって連通され、通気路93は真空圧パッキング用の ベローズ180を介してステージ本体2内の通気路18 2に接続される。この通気路182はステージ本体2の 側端部の近傍に設けられた電磁弁71aを介して受端口 70に接続されている。そして、ステージ本体2を構成 するセラミックス製ブロックの内部にはアクアラング用 ボンベと同様の立体形状で造形された複数のタンク室7 2 cが設けられ、各タンク室72 cはステージ本体2内 の通気路182に連通されている。

【0182】また本実施例では、ステージ本体2がベー ス定盤3の表面上に静圧気体軸受け用のエアバッドAP Dを介して支持されており、その気体軸受け用の加圧気 体は不図示のチューブを介して装置コラム側から別途に ステージ本体2に導かれているものとする。以上の図1 6の実施例では、ウェハ吸着時に真空圧による吸着力を なだらかに発生させるためのスピコン(図6中の71 c) が省略されているが、スピコンを設ける場合には図 16中の通気路182とベローズ180との間のステー ジ本体2側が望ましい。さらに図16では、吸着時の真 空圧をモニターする圧力センサ71eの配置、電磁弁7 ·1 aの開閉制御用の信号SV2の接続系等についての図 示を省略したが、それらの部分については先の図6、1 5と同様に構成すればよい。

【0183】また本実施例によれば、ステージ本体2を 構成するセラミックス製 (又は金属製) のブロック内に タンク室という空間を設けるため、ステージ本体2の軽 量化が可能となり、ステージ本体2の最高速度の向上、 加速度の向上、微小サーボ域での応答性の向上と言った 効果が得られる。また、本実施例のようにタンク室72 cをステージ本体2の構造物内に形成する場合は、構造 上で角を成す部分(例えばステージ本体2の四隅の部分 等) に球体として内蔵させると、タンク室の減圧による ステージ本体2の変形を最小限に抑えることが可能とな る。次に、図17を参照して本発明の第6の実施例によ る装置構成を説明する。本実施例では、真空吸着(又は 加圧気体の供給)時にステージ本体2側の受端口70と 渡ってウェハを自立吸着することが可能となる。さらに 40 ベース定盤3(又は装置コラム30)側の送端口84と の結合方式を変更し、滅圧気体や加圧気体の流路のスイ ッチングを電磁弁のようなアクティブ素子の代わりにバ ッシブな機械式弁機構77を使うことを特徴としてい

> 【0184】図17 (A), (B), (C)は、いずれ もステージ本体2側に設けられた機械式弁機構77の構 造と、装置3(30)側の固定部材83に設けられたパ イプ状の送端口84近傍の構造とを示す。そして図17 (A) はステージ本体2がローディング位置の手前に停 50 止して送端口84と弁機構77の受端口70とを一定間

隔で対向させた状態を表わし、図17(B)はステージ 本体2を送端口84側に微動させて、弁機構77の受端 □70の先端が送端□84を成すパイプの根元部分に当 接した状態を表し、図17(C)はステージ本体2が所 期のローディング位置に停止して弁機構77と送端口8 4とが完全に結合した状態を表わす。

【0185】図17(A)において、機械式弁機構77 は全体として筒状に構成され、その先端部にはスライド 可能な筒状の受端口70が取り付けられ、この受端口7 に面取りされている。また受端口70の先端には径を若 干大きくした環状のツバ部が形成され、そのツバ部の根 元部には気密性を良くするためのゴムや樹脂によるオー リング〇Sが設けられている。さらに、弁機構77の内 壁面に環状に形成された突出環77bと、受端口70の 終端部(同図の左端)との間には、受端口70を図17 (A) に示す位置に付勢するコイルバネ77 eが設けら れるとともに、受端口70を図17(A)の位置以上に 右側に移動させないストッパーも設けられている。

【0186】さて、弁機構77の内部で突出環77bの 20 左側にはピストン77aがスライド可能に設けられ、と のピストン77aはコイルバネ77cによって通常は突 出環77 b側に付勢される。そして、通常はピストン7 7 a が位置する弁機構 7 7 の壁部には通気路 7 7 d が形 成され、その通気路77 dには図6中に示したチューブ 73 (ホルダー10への通気路) が接続されている。と とで、コイルバネ77cの付勢力はコイルバネ77eの 付勢力よりも大きく定められ、受端口70は弱い力で弁 機構77内に押し込むととができる。

【0187】一方、セラミックス製または金属製の送端 30 □84は、図5、図6又は図13中に示した気体供給シ ステム81からのチューブ82に接続され、固定部材8 3を介して装置3に固定されている。送端口84の根元 には合成樹脂材によって円錐状に成形された干渉部材8 5 a が設けられ、この干渉部材85 a は受端口70の先 端部70 s との密着性を高めるために適度に弾性変形す る軟質材で作られている。

【0188】さらに、バイブ状の送端口84の内部には 通気路84aが形成され、との通気路84aは送端口8 4の先端近傍の側壁面に形成された開口84bと連通し 40 ている。そのためチューブ82から供給される真空圧や 加圧気体は、通気路84aを通って開口84bから外部 空間に供給される。ただし、図17(A)のように弁機 構77の受端口70と送端口84とが離れている状態で は、チューブ82の源にある電磁弁群(図6中の81 a、図13中の81a,86a等)は閉じられている。 【0189】さて、図17(A)の状態からステージ本 体2が右方向に微動していくと、機械式弁機構77の受 端□70の先端部70 sは図17(B)に示すように干

供給システム81からチューブ82を介して減圧気体を 一瞬だけ送端口84内の通気路84aに供給すると、図 17 (B) における受端口70の内側の閉空間は若干負 圧に設定される。この状態で送端口84の先端部84c はピストン77aに接触しないように設定されている。 【0190】さらに図17(B)の位置から、ステージ 本体2が受端口70のスライド可能距離だけ右側に微動 すると、受端口70は図17(C)に示すようにパネ7 7 e の付勢力に抗して弁機構77の内部に押し込まれ、 0の内壁先端部70 s は気密性を良くするために滑らか 10 オーリングOS は若干変形して弁機構77の筒状の先端 面と受端口70のツバ部との間をシールする。このと き、送端口84の先端部84cはピストン77aを所定 量だけ左側に押圧(換言すると弁機構77の円筒外壁の みが右側に移動)して、弁機構77の側壁に形成された 通気路77dが開放される。

> 【0191】とうして通気路77 dが開放される直前 に、チューブ82、送端口84の開口84bを介して加 圧気体が供給され、その加圧気体は通気路77dを通し てチューブ73に送出され、これによってホルダー10 上の露光済みウェハの吸着が瞬時に解除される。その 後、未露光ウェハがホルダー10上に載置されると、チ ューブ82、送端口84、通気路77d、チューブ73 を通して真空圧が供給され、未処理ウェハの吸着動作が 行われる。

> 【0192】ウェハのホルダー10への吸着完了が圧力 センサ71eによって確認されると、チューブ82の源 にある電磁弁群が閉じられ、ステージ本体2はそのまま 図17(C)の状態から左側に微動していき、やがてビ ストン77 aがバネ77 cの付勢力によって図17

> (B)の状態に復帰する。その後、図17(B)の状態 において、チューブ82を介して加圧気体を送端口84 から一瞬噴出して受端口70の内側の閉空間を若干陽圧 にしてから、ステージ本体2を図17(A)の位置まで 引き戻すことによって、一連のウェハ交換作業が終了す

【0193】尚、図17では図示を省略したが、今まで に説明してきたリザーブタンク72やタンク室72a. 72 cは、図17中のチューブ73の経路中に接続され て同様の自立吸着(減圧)システムが構築されている。 以上のように本実施例によれば、可動ステージ本体2を 所定のローディング位置に移動させ、その位置で弁機構 77の受端口70と送端口84とをステージ本体2の移 動推力で結合させるだけで、ステージ本体2に対する減 圧気体や加圧気体の供給路が自動的に形成されるととも に、ステージ本体2の弁機構77を送端口84から引き 離すだけでホルダー10によるウェハ吸着用の減圧路の 外気との連通が自動的に遮断される。

【0194】とのため本実施例によれば、ウェハ吸着用 の閉空間部(ホルダー10の吸着溝91~弁機構77の 渉部材85aの斜面部分に当接する。との状態で、気体 50 通気路77dまでの空間、タンク室内の空間)と外気と の連通を遮断する電磁弁等のアクティブな制御素子をス テージ本体2側に設ける必要がないので、それだけステ ージ本体2が軽量化されるといった利点がある。 さら に、ステージ本体2側に電磁弁が不要となるので、その ような電磁弁に信号SV2を供給する電気配線も不要と なるので、ステージ本体2が引き摺っていく配線の本数 をさらに少なくすることができる。次に、図18~22 を参照して本発明の第7の実施例について説明する。本 実施例では、可動ステージ本体2内で使われるウェハ吸 着用の真空系以外の空力系に対しても自立滅圧(吸着) システムや自立加圧システムを構築することを特徴とし

【0195】図18は、ローディング位置しDPにおい て、ステージ本体2の上部ステージ部2a上に取り付け られたホルダー10上にアーム42aによってウェハW を受け渡したり、ホルダー10上からアーム42aによ ってウェハ♥を受け取ったりする際に、ウェハ♥をホル ダー10の載置面10a(複数の突出部90)から所定 量だけ持ち上げるために設けられた3本のリフトピンP C1、PC2、PC3の配置を示す。

【0196】その3本のリフトピンPC1、PC2、P C3の先端面には、真空吸着用の小孔が形成され、3本 のリフトピン上に載置されたウェハWを一時的に吸着す る。との3本のリフトピンは、ホルダー10の中央部分 に形成された3つの貫通穴の各々を通して上下動可能に 設けられている。その3つの貫通穴の配置と大きさの関 係についての一例は、特開平1-214042号公報 (ニコン) に詳しく開示されているので、必要ならその 公報に開示された技術をそのまま、或は若干変形して利 用すればよい。

【0197】そのリフトビンはステージ本体2内に設け られたリフト機構によって上下動され、そのリフト機構 の一例は図19の部分断面図に示すように構成される。 図19では、3本のリフトピンのうち2本のリフトピン PC1、PC3のみが代表的に示されている。図19の 構成において、ホルダー10の中央部分にはリフトピン PC1, PC3の各々が接触することなく貫通する穴1 0 dが形成されている。そして図19は各リフトピンが 穴10dを貫通して最も上昇した場合を示し、ウェハW 間が形成される。さらに各リフトピンはその先端面がホ ルダー10の載置面10aよりも低い位置になるまで降 下可能である。

【0198】またホルダー10は、本実施例では不図示 の駆動モータによって上部ステージ部2a上で微小θ回 転可能に設けられ、ホルダー10の載置面10aの各吸 着溝91につながる自立吸着システムは、上部ステージ 部2aに設けられた通気路182、タンク室72c、及 び不図示の電磁弁等で構成され、先の各実施例と全く同 様に機能する。さらに上部ステージ部2aは、下部ステ 50

ージ部2 b に対する Z 軸方向の並進微動と、X 軸回りと Y軸回りの各微動傾斜とが可能なように構成される。 【0199】その結果ウェハ♥は、ステージ本体2上で θ回転運動、Z方向運動、及びXY方向の各傾斜運動の 4自由度で姿勢制御される。ただしホルダー10の6回 転運動は、図3に示した露光装置内でレチクルの方を θ 回転補正するような構成になっている場合は省略すると ともできる。との場合、ウェハWは下部ステージ部2b に対して3自由度(Z方向運動とXY方向の各傾斜運・ 動)で姿勢制御される。その3自由度の運動は、下部ス 10 テージ部2 bと上部ステージ部2 aとの間に設けられた 3つのZ方向駆動モータZM1~ZM3によって制御さ れる。

【0200】さて図19において、3本のリフトピンP C1~PC3は共通の台座122上に固定され、その台 座122は下部ステージ部2bに取り付けられた上下動 用のエアジャッキ124のピストン123に結合されて いる。エアジャッキ124は、下部ステージ部2bに形 成された通気路126とフレキシブルチューブ127と 20 を介して供給される加圧気体によってピストン123を 上昇させる。ピストン123の降下は、台座122とエ アジャッキ124との間に設けられたバネ125の引っ 張り弾性力を利用して、エアジャッキ124内(閉空間 部)の加圧気体を通気路126からスピコンを介して大 気に開放することで行われる。

【0201】また台座122には、チューブ121と下 部ステージ部2 b内の通気路120とを介して真空圧 (或いは加圧気体)が供給され、その真空圧(或いは加 圧気体) は台座122の内部を通してリフトビンPC1 30 ~ PC3の各先端面の小孔まで導かれる。その通気路1 20は、電磁弁を介して下部ステージ部2bの側端に設 けられた受端口に接続されると共に、自立吸着システム を可能とするためのタンク室にも接続されている。

【0202】尚、図19においてホルダー10に6回転 機構がない場合は、当然のことながらウェハに回転運動 を与えることができない。そこで本実施例では、ウェハ ₩をホルダー10に対して回転させるために、3本のリ フトピンPC1~PC3を支持する台座122、ピスト ン123、エアジャッキ124の全体を回転駆動系13 と載置面10aとの間にはアーム42aが進入し得る空 40 0によって下部ステージ部2bに対してXY面内で微小 回転させる機構を設けてある。以上の図18、19に示 されたリフト機構を搭載した2次元移動ステージ装置の 全体構成の一例を、図20を参照して簡単に説明する。 との図20に示されたステージ装置は、例えば特開昭6 1-209831号公報に開示の装置と類似のものであ るが、本発明を適用するために細部では若干改良、変形 が加えられている。また図20中の各構成部材のうち、 先の図1や図5中の構成部材と同一の機能のものについ ては同じ符号を付けてある。

【0203】図20において、平坦な表面を有するベー

10

ス定盤3の上には、X方向に直線状に延びた2つの固定 ガイド部材65A、65BがY方向に離れて取り付けら れ、各固定ガイド部材65A、65Bの間にはY方向に 直線状に延びた可動ガイド部材60が設けられる。との 可動ガイド部材60の両端部には、各固定ガイド部材6 5A、65Bとの間に流体軸受けを形成するためのエア パッドブロック60A、60Bが設けられている。また 可動ガイド部材60の下面には、その自重をベース定盤 3の表面で支えるための流体軸受け用のバッドが設けら れている。

【0204】可動ステージ本体2の下部ステージ体2b は、図20では上部ステージ体2aに隠れて図示されて いないが、可動ガイド部材60のY方向に延びた両側面 (又は片側面) に対して流体軸受けを介してX方向に拘 東され、その結果、可動ステージ本体2(2a)は可動 ガイド部材60に対してY方向に移動する。さらに可動 ステージ本体2の下部ステージ体2bの下面には、その 自重をベース定盤3の表面で支えるための流体軸受け用 のパッドが設けられている。

【0205】ステージ本体2のY方向の移動は可動ガイ 20 ド部材60に設けられたリニアモータ63によって行わ れ、ステージ本体2のX方向の移動はベース定盤3に設 けられた2つのリニアモータ66A、66BのX方向の 推力を可動子固定部60C、60Dを介し可動ガイド部 材60に伝えるととで実現される。ステージ本体2の上 部ステージ体2aには、レーザ干渉計6X、6Yの各々 から投射されるビームLBmx、LBmyを反射する移 動鏡5X、5Yが固定され、ステージ本体2の座標位置 や移動量が各干渉計に付設されたレシーバー7X、7Y からの測長信号に基づいて計測される。また上部ステー 30 ジ体2aに設けられたホルダー10にはウェハ♥が吸着 され、そのホルダー10を含む上部ステージ部2bの全 体は3つのZ方向駆動モータZM1~ZM3によって3 自由度で姿勢制御される。

【0206】さらに上部ステージ体2aには、投影光学 系PL(図3、図5参照)の投影視野 I Fを介してレチ クル側で検出可能な基準マークや発光パターンが形成さ れた基準マーク板CFPと、投影視野IF内に投影され たレチクルのマーク投影像を光電検出するための微小開 口部が形成された投影像検知板AISとが取り付けられ 40 ている。

【0207】そして可動ステージ本体2の下部ステージ 体2 bの角部には、図19に示した各種の空力系に減圧 気体(真空圧)を導くためのバイブ状の受端口70 v と、加圧気体を導くためのパイプ状の受端口70pとが X方向に突出するように設けられている。 とれらの受端 口70v,70pは、ステージ本体2上のホルダー10 の載置面の中心点Ocが所定のローディング位置LDP に停止すると、それぞれ固定部材83を介してベース定 る。

【0208】その送端口84 Vは気体供給システムから チューブ89aを通して送られてくる減圧気体を送出 し、送端口84 pは気体供給システムからチューブ89 bを通して送られてくる加圧気体を送出する。本実施例 の場合、受端口70 v, 70 p と送端口84 v, 84 p の各構造は先の図6に示したものと同じである。ととろ で図20に示したステージ装置は、ステップアンドスキ ャン方式の投影露光装置に適用することを意図してお り、このためウェハW上の1つのショット領域SAは、

円形の投影視野IF内で直径方向に直線的に延びたスリ ット状又は長方形状に制限された実効的な投影像領域P **亅によって走査露光される。**

【0209】その場合、走査露光のためのウェハWの移 動方向は、投影像領域PIの長軸方向と直交したY方向 に設定されるが、本実施例のステージ装置ではその走査 移動を可動ステージ本体2のみで行うようにしたため、 高速で髙精度な走査露光が実現できる。ただし、走査方 向がY方向であっても走査露光中はウェハWをX方向に も微動させる必要があるので、可動ガイド部材60もX 方向に微動させることになる。

【0210】ところが図20の構成で走査露光の方向を X方向にしてしまうと、ウェハW上の各ショット領域S Aの露光のたびに、可動ガイド部材60とステージ本体 2を共にX方向に高速に等速移動させなければならず、 走査中のステージ制御精度を高めるのに苦労する。それ 以外にも、可動ガイド部材60とステージ本体2との両 方で決まる大質量の可動体が各ショット領域の露光のた びに急加速、急減速を繰り返することから、露光装置本 体内で非常に大きな反力が発生する。

【0211】とのため露光装置に不要な振動を発生させ たり、露光装置内のコラム等の構造体に不要な変形を与 えることが懸念される。しかしながら、走査露光時のス テージ本体2の移動をY方向にしておけば、加減速を繰 り返す可動体の質量が小さくなるため、それだけ振動の 発生や構造体の変形等が低減されることになる。尚、図 20に示したウェハステージ装置は一例であって、その 他にも特開平8-166475号公報や特開平8-23 3964号公報に開示されているような複数個のリニア モータとフォロワー構造とを備えたステージ装置がその まま、或は若干の変更を加えて本願発明のステージ装置 として適用可能である。次に図21を参照して、図18 ~20の装置構成のステージ本体2内に設けられる好適 な空力系(真空吸着系、加圧系)の構成を説明する。 と こでは、ウェハWを真空吸着するホルダー10の吸着溝 91に真空圧(或は加圧気体)を供給する電磁弁71 a、通気路182、タンク室72c、及びチューブ73 等で構築されるウェハの自立吸着システムと、上部ステ ーシ部2 a 上でθ回転可能なホルダー10をθ回転後に 盤3に取り付けられた送端口84v、84pと結合され 50 真空吸着するパッド部(凹部)144に真空圧(或は大

気圧)を供給する電磁弁140、141とタンク室72 d等で構築されるホルダーの自立吸着システムと、ウェ ハを真空吸着するリフトピンPC1~PC3の吸着孔に 真空圧 (或は加圧気体)を供給する電磁弁150、タン ク室72e、通気路120、及びチューブ121等で構 築されるリフトピンの自立吸着システムと、リフトピン PC1~PC3を上下動するエアジャッキ124に加圧 気体を供給する電磁弁152、通気路126、チューブ 127等で構築される自立加圧システムとが設けられて いる。

55

【0212】3つの自立吸着システムの各々の電磁弁7 1a、140、150には、チューブ160 vを介して 受端口70 vからの真空圧が供給され、ウェハの自立吸 着システムの電磁弁71a、リフトピンの自立吸着シス テムの電磁弁150、及びエアジャッキ用の自立加圧シ ステムの電磁弁152の各々には、チューブ160pを 介して受端口70 pからの加圧気体が供給される。

【0213】この図21の構成において、電磁弁71a は先の図6に示したものと若干異なる機能を有し、とと ではチューブ160 vからの真空圧とチューブ160 p 20 からの加圧気体とを択一的に通気路182に送出する切 り換え機能の他に、通気路182をチューブ160 v、 160pのいずれとも接続しない非接続状態(中立状 態)に切り換わる機能も備えている。同様に電磁弁15 0も、真空圧と加圧気体との切り換え機能の他に、その どちらとも接続されない中立状態に切り換わる機能を備 えている。

【0214】さらに、電磁弁141は真空圧のバッド部 144への供給とポート142を介したパッド部144 圧気体のエアジャッキ124への供給とポート153を 介したエアジャッキ124の大気(或はスピコン)開放 との切り換え機能を備える。また電磁弁140は真空圧 の通路を単純に開放、遮断する機能を備えている。

【0215】一方、図21の受端口70v, 70pと接 続されるベース定盤3側の送端口84 v. 84 pは、一 例として図22のように構成される。との図22に示し た気体供給システムは、真空圧用の送端口84 v と加圧 気体用の送端口84pとが分離しただけで、基本的には 先の図13と同様に構成される。すなわち、送端口84 vにはチューブ80a、電磁弁81a、スピコン87 a、及びチューブ89aを介して真空圧供給源からの真 空圧が供給され、送端口84pにはチューブ80b、電 磁弁86a、スピコン88a、及びチューブ89bを介 して加圧気体供給源からの加圧気体が供給される。

【0216】さらに本実施例の場合、ステージ本体2側 の各電磁弁71a, 140, 141, 152を制御した り、図19中の回転駆動部130、ホルダー10の日回 転用のモータ等を制御したりするための信号群SQn は、ベース定盤3の固定部材83に設けられた送電端子 50 されている。

部84kを通してステージ本体2側の受電端子部71k で受信されるような構成(先の図15と同様の構成)に なっている。

【0217】以上の図21、22の空力系が組み込まれ た図19、20の露光装置におけるウェハ交換作業は、 図23に示したタイムチャートに従って実行される。と の図23のタイムチャートは、ステージ本体2がローデ ィング位置LDPに停止して受端口70v,70pがそ れぞれ送端口84v,84pと結合した直後から、一連 のウェハ交換が終了した時点 (ステージ本体2がローデ ィング位置から移動可能となる時点)までの動作を表し ている。

【0218】また図23において、横軸は時間軸を表 し、最上段のチャートはウェハ交換の全体動作を成す露 光済みウェハのアンローディング動作と未露光ウェハの ローディング動作とにおける細目的な部分動作を表す。 さらに図23の2~8段目のチャートは、図21、22 に示した電磁弁71a,81a,86a,150,15 2, 140, 142の各作動状態を示す。また電磁弁7 1a, 150, 152, 142には、入出力の択一的な 接続の切り換え以外に入出力をどこにも接続しない中立 状態があり、その中立状態をチャート上ではNで表して ある。

【0219】露光済みウェハのアンローディング動作 は、図23の最上段のチャートに示したように、ホルダ ー10上の露光済みウェハの吸着解除、図18, 19, 21に示したリフトピンPC1~PC3の上昇(ウェハ 持ち上げ)、搬送アーム42aのホルダー10とウェハ との間への進入(図19参照)、リフトピンPC1~P の大気開放との切り換え機能を備え、電磁弁152は加 30 C3の降下(ウェハのアーム42aへの受渡し)、及び 露光済みウェハを保持したアーム42aの退出とによっ て実行される。

> 【0220】同様に未露光ウェハのローディング動作 は、未露光ウェハを保持したアーム42aのホルダー1 0の上方空間への進入、リフトピンPCI~PC3の上 昇(未露光ウェハの受取り)、空になったアーム42 a の退出、リフトピンPC1~PC3の降下(未露光ウェ ハのホルダー10への受渡し)、及び未露光ウェハのホ ルダー10への真空吸着とによって実行される。

【0221】まず、露光済みウェハのアンローディング 動作が始まる直前において、電磁弁71aは中立状態N になっており、図21の接続から明らかなように露光済 みウェハはホルダー10上にタンク室72cの作用で自 立吸着されている。とのとき、図22中の電磁弁81 a. 86 a と 図 2 1 中の電磁弁 1 4 0 はいずれも遮断状 態(閉成状態)であり、図21中の電磁弁150,15 2は中立状態Nになっている。そして図21中の電磁弁 142は真空側への接続状態になっており、ホルダー1 0はタンク室72dの作用でパッド部144に自立吸着

【0222】ウェハの吸着解除動作では、まず電磁弁7 1aが加圧側に切り換えられ、図21中の受端口70p がチューブ160p、電磁弁71aを通してチューブ1 82と連通される。すると直ちに、図22中の電磁弁8 6 a が開放状態に切り換えられ、加圧気体が送端口8 4 pを通して受端口70pに供給され、タンク室72c内 とホルダー10の吸着溝91までの通路とが陽圧にな り、ホルダー10上の露光済みウェハの吸着が瞬時に解 除される。このとき、ウェハはホルダー10の載置面に 対して数 µm程度で浮上し得る。

57

【0223】次に、電磁弁71aを中立状態Nに切り換 えて、リフトピンPC1~PC3の上昇動作に移行す る。このとき図22中の電磁弁81aが開放状態に切り 換えられて、図21中の受端口70 vからチューブ16 0 vまでの通路内は真空圧にされる。同時に電磁弁86 aも開放のままであるために、受端口70pからチュー ブ160 pまでの通路内は加圧気体で満たされる。その 直後に、図21中の電磁弁150が真空側(チューブ1 60 vと通気路120との接続状態)に切り換えられ、 路126との接続状態)に切り換えられる。

【0224】 これにより、エアジャッキ124内に加圧 気体が供給されてリフトピンPC1~PC3が上昇し、 同時にタンク室72e内、通気路120、チューブ12 1に真空圧が導かれて、リフトピンPC1~PC3の先 端面での吸着動作(ととでは小孔による大気の吸引動 作)が開始される。そしてリフトピンPC1~PC3が 所定位置まで上昇し終わる所定のタイミングで電磁弁 1 52は中立状態Nに切り換わり、露光済みウェハがホル ダー10から持ち上げられてリフトピンPC1~PC3 の先端に真空吸着されたことが確認されると、電磁弁1 50が真空側から中立状態Nに切り換えられ、リフトビ ン上昇動作が終了する。

【0225】このとき、電磁弁152と150が共に中 立状態Nにあるため、エアジャッキ124は自立加圧状 態となっており、リフトピンPC1~PC3はタンク室 72 eの作用で露光済みウェハを自立吸着している。そ の後、安全のために電磁弁81a(真空圧の供給)が遮 断されて、次のアーム進入動作に移行する。ところで、 着を解除させておく必要がある。そのタイミングはウェ ハ交換動作の前、或はその最中であれば何処でもよい が、ととでは露光済みウェハをホルダー10から持ち上 げるリフトピンの上昇動作の期間に行うものとする。そ こで本実施例では、リフトピンの上昇中の適当なタイミ ングで電磁弁142を真空側(図21でパッド部144 とタンク室72 dとが連通した状態) から大気側 (バッ ド部144とボート142とが連通した状態) に切り換 えておくものとする。

ロボット40のアーム40aが図19のように、持ち上 げられた露光済みウェハとホルダー10との間の空間に 進入し終わると、リフトピンの降下動作が行われる。と の場合、まず電磁弁152が大気側(エアジャッキ12 4に繋がる通気路126とポート153とが連通した状 態) に切り換えられ、リフトピンPC1~PC3の降下 が開始される。そしてその直後に電磁弁150が加圧側 (通気路120とチューブ160pの接続状態) に切り 換えられて、リフトピンPC1~PC3による露光済み 10 ウェハの吸着が瞬時に解除される。

【0227】ところが、リフトピンPC1~PC3上の ウェハの吸着解除を加圧気体によって瞬時に行う場合、 そのまま加圧気体を供給し続けるとリフトピンPC1~ PC3上でウェハが踊ってしまい、搬送に支障を来す。 そとで、電磁弁150を加圧側に切り換えてから、タン ク室72e内とリフトピンPC1~PC3までの通路内 とが僅かに陽圧になるタイミングを見計らって、図22 中の電磁弁86 aを遮断状態に切り換える。

【0228】との間、リフトピPC1~PC3は降下を 電磁弁152が直ちに加圧側(チューブ160pと通気 20 続け、露光済みウェハは搬送アーム42a上に受け渡さ れ、アーム42 a は露光済みウェハを真空吸着してホル ダー10の上方空間から退出する。この際、本実施例で は安全のためにリフトピンPC1~PC3はホルダー1 0の載置面10aよりも僅かに下方まで降下して停止す るものとする。以上の一連のシーケンスによって露光済 みウェハのアンローディング動作が終了すると、次に図 23に示した未露光ウェハのローディング動作が実行さ

【0229】ローディング動作においては、まず、未露 光ウェハを吸着したアーム42aがホルダー10の上方 空間に進入する。それと同時に、電磁弁86 aが開放状 態に切り換えられて、送端口84pと受端口70pとを 介してステージ本体2側のチューブ160p内に加圧気 体が供給される。そしてアーム42aが所定位置に進入 し終わると、電磁弁81aが開放状態に切り換えられる とともに電磁弁152が加圧側に切り換えられて、リフ トピンPC1~PC3の上昇動作が開始される。との動 作は、電磁弁150,152の切り換えタイミングに若 干の差異はあるものの、先に説明した露光済みウェハの 図21に示したバッド部144は適当なタイミングで吸 40 アンローディング時のリフトピン上昇動作とほぼ同じで ある。

> 【0230】とのリフトビン上昇動作によって、アーム 42a上の未露光ウェハはリフトピンPC1~PC3上 に受け渡され、そとで真空吸着される。とのような未露 光ウェハのリフトピンPC1~PC3への受け渡し動作 の間に、図21中の電磁弁142は中立状態Nに切り換 えられる。ただしその切り換えの後であっても、バッド 部144内とタンク室72d内とは依然として大気圧の ままである。

【0226】さて、リフトピンが上昇した状態で、搬送 50 【0231】未露光ウェハがリフトピンPC1~PC3

20

上に吸着されると、電磁弁150,152が共に中立状 態Nに切り換えられ、リフトピンPC1~PC3の自立 吸着とエアジャッキ124内の自立加圧とが開始され る。その直後、アーム42aがホルダー10の上方空間 から退出するが、その間の時間を利用して電磁弁140 が開放状態に切り換えられて、チューブ160 vまで供 給されている真空圧をタンク室72d内に導びく。この 動作は、ステージ本体2がローディング位置から離れた

59

後にホルダー10を 日回転させてパッド部144で吸着 固定するアライメント法を採る場合には、タンク室72 10 dを予め真空圧に維持しておくために必要である。 【0232】次にリフトビンの降下動作が行われるが、

との動作は、電磁弁152, 150, 86aの切り換え タイミングに若干の差異はあるものの、基本的には先の **露光済みウェハのアンローディング時におけるリフトビ** ン降下動作と同じであるので、詳細な説明は省略する。 ただしことで異なる点は、リフトピンPC1~PC3の 降下が始まった後に、図21中の電磁弁71aが真空側 (チューブ182とチューブ160 v との接続状態) に 切り換えられることである。すなわち、リフトピンPC 1~PC3によって未露光ウェハがホルダー10上に降 下移動している間に、リフトピンPC1~PC3による 吸着が解除(電磁弁150の加圧側への切り換え)され つつ、ホルダー10による吸着動作が開始される。

【0233】ただし本実施例では、安全のために電磁弁 71aが真空側に切り換わる直前に電磁弁140が遮断 状態に切り換わるように設定されている。これは真空圧 の大きな変動を避けるためであり、そのタイミングの際 にタンク室72d内が十分に真空元圧まで減圧されてい れば、殊更そのタイミングで電磁弁140を遮断しなく 30 ログラム(たたし監視履歴メモリに書き込む情報は個 てもよい。

【0234】以上の動作によって未露光ウェハはホルダ -10上に真空吸着されるが、電磁弁71aが真空側で あって、かつ電磁弁81aが開放状態の間に、ウェハ搬 送ユニット内のCPUは圧力センサ71eからの信号S pを読み込んで、異常なリークが生じているか否かを判 定する。そして問題がないと判断されると、そのCPU はまず電磁弁81aの方を遮断状態に切り換え、ホルダ ー10をタンク室72c内の真空圧による自立吸着状態 にもたらす。

【0235】その時点で、先の図7中のステップ226 と図11の監視プログラムGとが実行され、CPU(図 6中の制御ボード5 l a内のプロセッサ) はタイマーモ ードの早いサンプリング間隔 (例えば2mS毎) 毎に監視 履歴メモリ内に蓄積される吸着圧の変化率ΔPnをモニ ターする。そして所定時間(例えば50~100mS)の 間に変化率ΔΡηに変動がない場合、СРUは未露光ウ ェハがホルダー10上に正常吸着されたものと判断し て、電磁弁71 aを中立状態Nに切り換える。これによ 露光ウェハを自立吸着し、以後、ステージ本体2はロー ディング位置から任意の方向に移動可能となる。

【0236】また、監視プログラムGの実行にあたっ て、ウェハがホルダー10上に自立吸着された直後は信 号Spの読み込み間隔をかなり短く(例えば1秒以下) しておき、引き続く数秒~1分程度の間に吸着力の大き な低下が認められないときは、信号Spの読み込み間隔 を数秒以上に長くするように自動的に変更させることも できる。

【0237】ところで、未露光ウェハに対して重ね合せ 露光を行う場合は、ウェハ交換作業の後でステージ本体 2を投影光学系 PLの下に移動させて、未露光ヴェハ上 の複数ヶ所の各アライメントマークを露光装置内の各種 のアライメント光学系を用いて検出するアライメント作 業が実行される。そのアライメント作業の1つとして、 未露光ウェハ上のショット配列座標とステージ本体2の 移動座標系(干渉計6 X、6 Yで規定される座標系)と の相対回転誤差を計測して、その回転誤差分が補正され るようにホルダー10をθ回転させることがある。

【0238】その場合、ホルダー10は日回転の後にス テージ本体2に対して固定される必要があるため、図2 1に示したパッド部144が真空吸着を行う。そとでホ ルダー10がθ回転した後、図21中の電磁弁141を 中立状態 Nから真空側(タンク室72 dとバッド部14 4との連通状態)に切り換える。これによってパッド部 144は、タンク室72dを利用してホルダー10を自 立吸着する。このため、必要に応じてパッド部144で の吸着力の変化を監視するプログラムを、ウェハ吸着用 の監視プログラムG(図11)とは別個に、或は同じプ 別)として起動することが望ましい。以上の各実施例で はウェハ等の感光基板を載置するステージ装置を対象と したが、本発明は露光装置内のレチクルやマスク等の原 画基板を載置するステージ装置に対しても同様に適用可 能である。特に本発明は、レチクルに形成された回路バ ターンをステップアンドスキャン方式で感光基板上に転 写する図3の投影露光装置のスキャン型レチクルステー ジに適用すると効果的である。そとで図24を参照して 本発明の第8の実施例によるレチクルステージ装置の構 40 成を説明する。

【0239】図24は、図3に示した露光装置中のレチ クルステージ26とそのベース部28との詳細な構成の 一例を示す斜視図であり、ベース部材28はセラミック ス材により一体形成されている。そしてベース部材28 のXY面と平行な上面には、Y方向に延設された2つの ガイド面28a, 28bが形成され、ベース部材28の X方向の一端部にはYZ面と平行にY方向に延設された ガイド面28cが形成されている。そしてベース部材2 8の中央には、レチクルR上の回路パターン領域PAの って、ホルダー10はタンク室72cの作用によって未 50 投影光路を遮蔽しないような開口28dが形成されてい る。

【0240】一方、レチクルステージ本体26は、3つ のガイド面28a, 28b, 28cの各々に対して静圧 気体軸受パッド400, 401a, 402a, 402b で拘束されて Y方向に 1次元移動するスキャンステージ 部26bと、そのスキャンステージ部26b上でX、Y 方向とθ方向(回転方向)とに微動すると共にレチクル Rを真空吸着するレチクルホルダー26aとで構成され ている。レチクルホルダー26 a は、スキャンステージ 部26 b 上の3、4ヶ所に設けられる不図示の微小直動 10 アクチュエータ(ビエゾ伸縮素子、ボイスコイル型モー タ等) によってX、Y方向とθ方向とに微動される。 【0241】とのようなレチクルステージ本体26は、 連結部材26cの先端部に設けられた可動子410aと ベース部材28の側部に設けられた固定子410bとで 構成されるリニアモータ410によってY方向に1次元 移動される。またレチクルホルダー26a上には、レチ クルRの下面の複数ヶ所を真空吸着する複数の吸着パッ ド部412と、レチクルRのY方向の位置とθ回転とを 計測するレーザ干渉計からのビームBMy1, BMy2 を反射するコーナー鏡414a、414bと、レチクル RのX方向の位置を計測するレーザ干渉計からのビーム BMxを反射する角柱状の移動鏡414cと、走査露光 直前のレチクルステージ本体26の位置(図24の状 態)においてスリット状又は長方形に制限された露光用 照明光 (例えば図20中の投影像領域PIを生成)を受 光する照度分布計測器416とが設けられている。なお 図24において、レチクルステージ本体26は、照度分 布計測器416がX方向にスリット状に延びる露光用照 明光の下にちょうど配置されるような助走開始位置に設 30 定されている。

【0242】そしてスキャンステージ部26bのY方向の端部には、レチクルRの吸着パッド部412への真空路と連通し得る受端口70が設けられる。さらに、レチクルステージ本体26が所定のスタンパイ位置、ここでは図24中の右端近傍に停止したときに受端口70と結合する送端口84がベース部材28側に設けられている。その送端口84は固定部材83を介してベース部材28に取り付けられ、チューブ418を通して気体供給システムに接続される。その気体供給システムを先に図13に示したシステム81と同様に構成するものとすれば、チューブ418は図13中のチューブ82に相当する。

【0243】図24に示した受端口70と送端口84は、先に図17で説明した機械式弁機構とするのが望ましいが、それに限定されるととなく、図6、図15、図21、22に示した電磁弁併用の構成であってもよい。いずれにしろ本実施例でも、レチクルRを真空吸着するパッド部412から受端口70までの通気路(閉空間部)のみの容債だけでは十分な吸着持続時間が得られな

いため、スキャンステージ部26b、或いはレチクルホルダー26a内にリザーブタンク、タンク室等の容積拡張部材(即ち吸着用エネルギーの蓄積部材)が設けられる。

62

【0244】以上の図24のレチクルステージ装置は、例えば先の図1、図20のウェハステージ装置と同期して、レチクルRとウェハWとが投影光学系PLの投影視野1Fに対して所定の速度比でY方向に等速移動するように制御される。これによってウェハW上の1つのショット領域SAが走査露光されると、隣のショット領域を露光すべくウェハステージ本体2がX方向にステッピングされる。そして再び、レチクルステージ本体26とウェハステージ本体2とが各々Y方向の逆方向に走査移動される。

【0245】従って、図24のレチクルステージ装置だけを見てみると、1枚のウェハWをステップアンドスキャン露光している間、レチクルステージ本体26はベース部材28のガイド面28a、28b、28cに沿って各ショット領域毎に単に往復運動するに過ぎない。そのため本実施例においては、レチクルステージ本体26の走査露光中における往復運動のストローク内では受端口70と送端口84とが離れ、そのストロークを越えてレチクルステージ本体26がレチクル交換のためのロード/アンロード位置(図24中の最も右端のスタンパイ位置)にくると受端口70と送端口84とが密着結合されるように設定される。

【0246】そして本実施例においても、レチクル交換 作業中は送端口84、受端口70を介して吸着パッド部 412に真空圧(或いは加圧気体)が供給され、受端口 70が送端口84から離れるときはレチクルステージ本 体26に設けられた容積拡張部材(タンク室等)によっ てレチクルRの自立吸着が行われる。さらに本実施例で も、その自立吸着システムが正常に機能しているか、そ の吸着力がレチクルステージ本体26の加減速に対して 十分であるか否か等を常時判断する吸着監視プログラム が、先の図11のフローチャートと同様に実行される。 【0247】ところで本実施例によるレチクルステージ 装置においても、先の図2と同様にバッテリー100や 無線式トランスミッター(106,108)等を内蔵す るととによって、レチクルステージ本体26に搭載され る各種の電気的駆動系や電気的検出系とベース部材28 との間に接続される電気信号線を省略したり、その本数 を低減したりすることができる。その一例としては、図 24中の照度分布計測器 (光電検出器) 416で検出さ れる露光用照明光の光強度に応じた光電信号をA/D変 換器によりデジタル値に変換し、そのデジタル値を無線 式トランスミッターで制御ラック50(図3参照)に送 信する構成が考えられる。

【0248】その他、レチクルRの吸着を真空圧ではなく図1中のウェハホルダー10のように静電圧にすると

50

とも可能である。その場合は、レチクルステージ本体26のホルダー26aのレチクル載置面に静電吸着用の電極を設けると共に、図2と同様にしてレチクルステージ本体26に内蔵されたバッテリー100から給電される高電圧制御回路112を設ければよい。

【0249】以上のととから、可動ステージ本体内で必要とされる吸着動作に真空圧を利用するか静電圧を利用するかは本質的な差異ではなく、むしろ実質的に同一の範疇に含まれるものである。すなわち、真空吸着の場合のリザーブタンクやタンク室等の容積拡張部材と、静電10吸着の場合の再充電可能なバッテリー(コンデンサー)とは吸着力持続用のエネルギー源として機能する点で同じものである。

【0250】さらに、可動ステージ本体内に設けられたアクチュエータを空力系で構成するか電気系で構成するかも本質的な差異ではなく、空力系の場合のリザーブタンクやタンク室等の容積拡張部材と弁機構の組合わせ機能は、電気系の場合における電気的駆動源の内蔵バッテリー(コンデンサー)による自己エネルギー補給と言った自立制御の観点からは同じ機能を成すものである。

【0251】ところで上記の各実施例の説明では、半導体ウェハ上に回路パターンを露光することでメモリデバイスやマイクロプロセッサ等の半導体回路デバイスを製造する露光装置に適用される移動ステージ装置を前提にした。しかしながら本発明は、例えば特開平7-326567号公報に開示されているように、液晶方式やプラズマ方式のフラット表示デバイス等に使われる大型ガラス基板上に回路パターン(画素、透明電極、薄膜トランジスタ等)を形成するために使われる走査露光装置にも同様に適用できる。

【0252】その公報に開示された走査露光装置は、大型ガラス基板を被露光基板として縦に配置し、このガラス基板に転写すべきパターンが描画されたマスク基板(レチクル)を縦に配置するように構成され、それらのガラス基板(被露光基板)とマスク基板とは投影光学系を挟んで1次元移動のキャリッジ内に一体的に保持される。従ってそのような走査露光装置の場合は、被露光基板とマスク基板とを一体に保持するキャリッジが、各実施例で説明した可動ステージ本体2(2a、2b)に対応するととになる。

[0253]

【発明の効果】以上のように、本発明による可動ステージ装置によれば、可動ステージ本体に接続される電力供給用、通信用の各種の電気配線類や真空圧用、加圧気体用のフレキシブルチューブ類をほぼ完全に省略するとと、或はその本数を低減することが可能となり、電気配線やチューブのテンションやそれら自体の振動等による可動ステージ本体の移動特性や停止精度の劣化を抑えることができる。

【0254】また本発明では、可動ステージ本体に供給 50 装置の構造を示す部分断面図である。

される真空圧、或は加圧気体の開放/遮断を切り換えるために、1個若しくは複数個の弁機構を可動ステージ本体側に設けるようにしたので、各種チューブの本数を積極的に低減することが可能となる。さらに本発明によれば、複数枚の被処理基板や被露光基板を可動ステージ本体上に順次交換して載置する期間を利用してバッテリーの充電や予備減圧室(タンク室等)の減圧を行うので、リソグラフィ工程におけるスルーブットを低下させることなく、半導体デバイスを量産製造できるといった効果も得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施例による可動ステージ 装置の全体的な構成を示す斜視図である。

【図2】 図1の可動ステージ装置のステージ本体に 搭載される電気系の構成を示す回路ブロック図である。

【図3】 図1の可動ステージ装置が搭載される役別 露光装置の全体的な構成を示す斜視図である。

【図4】 図1~3による装置によるウェハ交換動作とバッテリー充電動作とを説明するフローチャート図で20 ある。

【図5】 本発明の第2の実施例による可動ステージ 装置の全体構成を示す側面図である。

【図6】 図5の装置に適用されるステージ本体側の 真空吸着路の構成と、ベース定盤側の真空圧供給システムの構成とを示すブロック図である。

【図7】 図5、図6の装置によってウェハ吸着を行うときの主動作(プログラムA)を説明するフローチャート図である。

【図8】 図7のフローチャート中で分岐するエラー 30 処理動作(プログラムB.D)を説明するフローチャー ト図である。

【図9】 図7のフローチャート中で分岐するウェハ 交換動作(プログラムC)を説明するフローチャート図 である。

【図10】 図3の露光装置に設けられたウェハ搬送ロボットの詳細な構成の一例を示す図である。

【図11】 図6の装置によるウェハ吸着方式において 起動される吸着力の監視プログラムを説明するフローチャート図である。

40 【図12】 吸着監視プログラムで判断される真空圧の 各許容値の関係を模式的に示すグラフである。

【図13】 本発明の第3の実施例による気体供給システムの構成を示すブロック図である。

【図14】 図13のシステムを図5の露光装置に適用 したときのウェハ交換動作のシーケンス例を説明するタ イムチャート図である。

【図15】 本発明の第4の実施例による可動ステージ 装置の構造を示す部分断面図である。

【図16】 本発明の第5の実施例による可動ステージ 装置の構造を示す部分断面図である。

特開平1	0 –	2	7	0	5	3	5
------	-----	---	---	---	---	---	---

66

(34)

65 【図17】 本発明の第6の実施例による弁機構による 受端口と送端口の各構造を示す断面図である。

【図18】 本発明の第7の実施例による可動ステージ 装置におけるウェハのリフト機構の外観を示す斜視図で ある。

【図19】 図18のリフト機構を搭載したステージ装置の構成における断面の一例を示す図である。

【図20】 図18、図19のリフト機構を搭載した可動ステージ装置の全体的な構成を示す上面図である。

【図21】 図19、図20に示した可動ステージ装置 10 のステージ本体側に搭載される空力系の配管を説明する ブロック図である。

【図22】 図19、図20に示した可動ステージ装置のベース定盤側に設けられる気体供給システムの配管を説明するブロック図である。

【図23】 図21、図22の装置のウェハ交換作業中 における各動作を説明するタイムチャート図である。

[図24] 本発明の第8の実施例によるレチクルステージ装置の構成を示す斜視図である。

【符号の簡単な説明】

W, W', W" · · · · ウェハ

R ・・・ レチクル.

PL ··· 投影光学系

1 ・・・ 移動ステージ装置

2 ・・・ 可動ステージ本体

2a ・・・ 上側ステージ部

2 b ・・・ 下側ステージ部

Z D | | | | | | | | |

3 ・・・ ベース定盤

6X, 6Y · · · レーザ干渉計

9 a · · · · 受電端子部

9 b · · · 送電端子部

10 ・・・ ホルダー

20 ・・・ レーザ光源

24 ・・・ 照明系

*26 ・・・ レチクルステージ本体

30 ・・・ 装置コラム

40 ・・・ ウェハ搬送ロボット

50 ・・・ 制御ラック

51 ・・・ ユニット制御ボード群

52 ・・・ ミニコンピュータ

63, 66 · · · リニアモータ

70,70v,70p · · · · 受端口

71 ・・・ 電磁弁ユニット

0 71a ・・・ 電磁弁

71e ・・・ 圧力センサー

71k · · · · 受電端子部

72 ・・・ リザーブタンク

72a, 72c, 72d, 72e ・・・ タンク室

77 ・・・ 機械式弁機構

81 ・・・ 気体供給システム

81a · · · 電磁弁

84,84 v,84 p · · · 送端口

84k · · · 送電端子部

20 91 · · · 吸着溝

100 ・・・ バッテリー

102 ・・・ 充電/通信カプラ回路

106 · · · · RFC (無線送受信器)

110 · · · CPU

112 · · · · 高電圧制御回路

114, 116, 118 ・・・ モータドライブ回路

122 ・・・ リフトピンの台座

124 ・・・ エアジャッキ

144 ・・・ 吸着パッド

30 XM1, XM2 · · · X方向の電磁推進モータ

YM1, YM2 ··· Y方向の電磁推進モータ

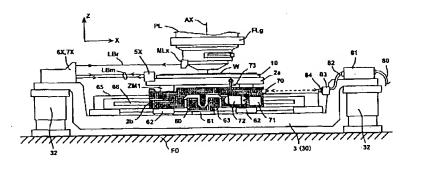
ZM1, ZM2, ZM3 ··· Z方向駆動モータ

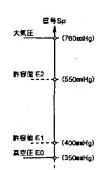
LDP ・・・ ローディング位置

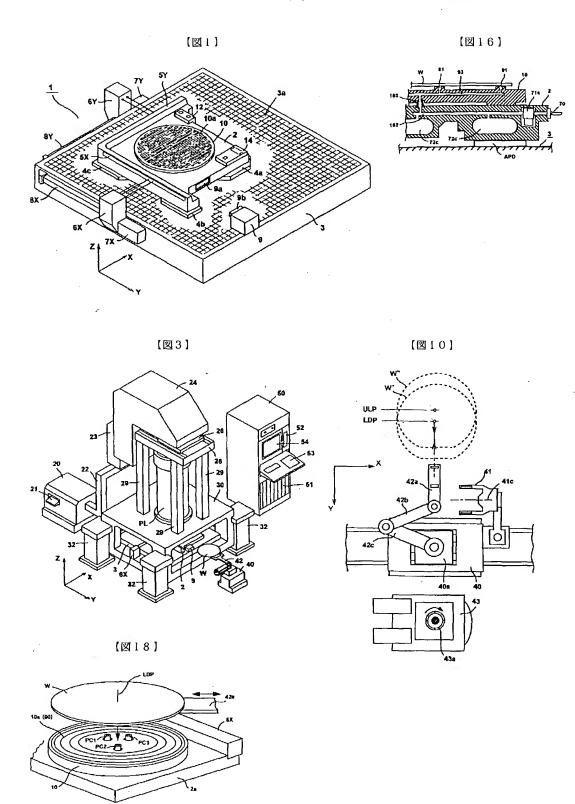
* ULP ・・・ アンローディング位置

【図5】

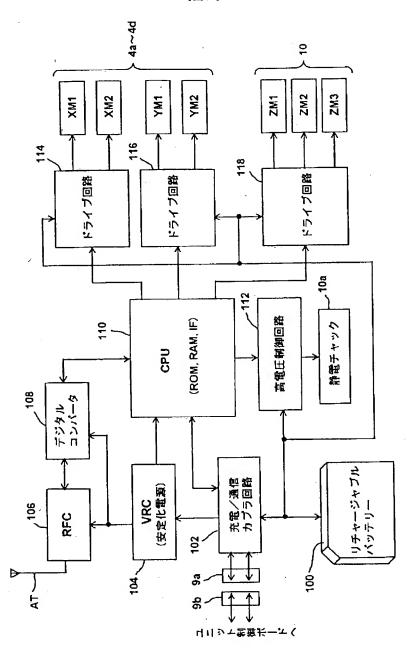
【図12】



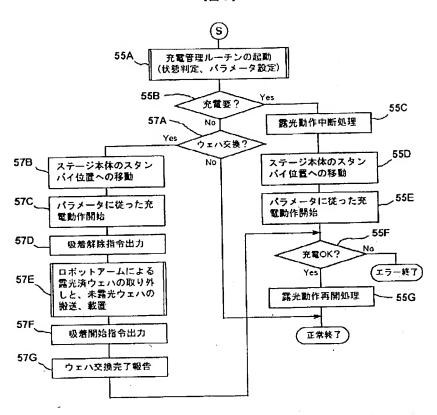




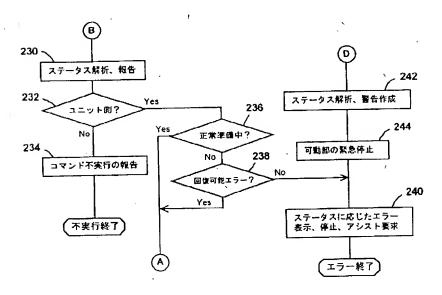
【図2】



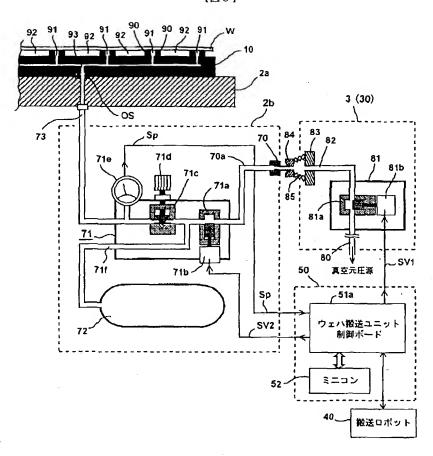
【図4】



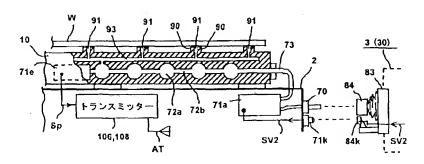
【図8】



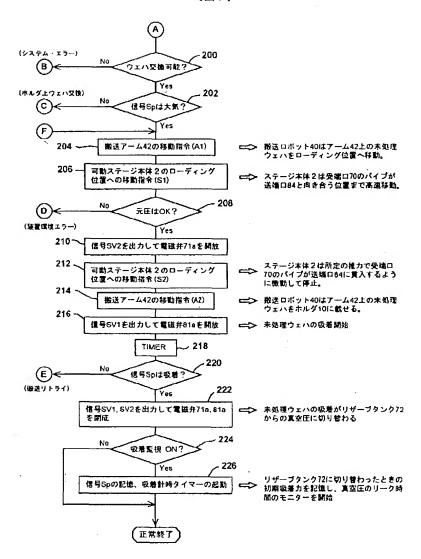
【図6】



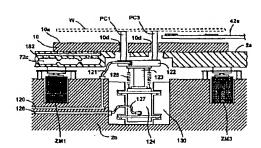
【図15】

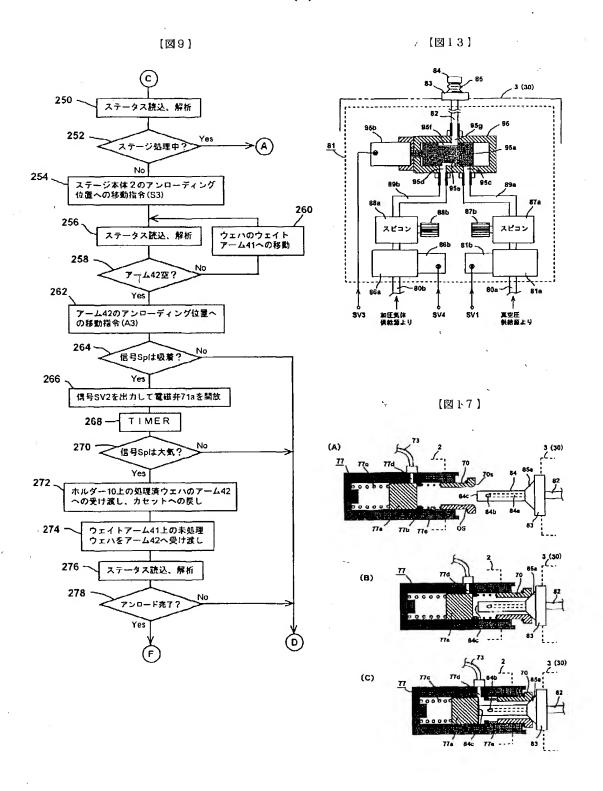


【図7】

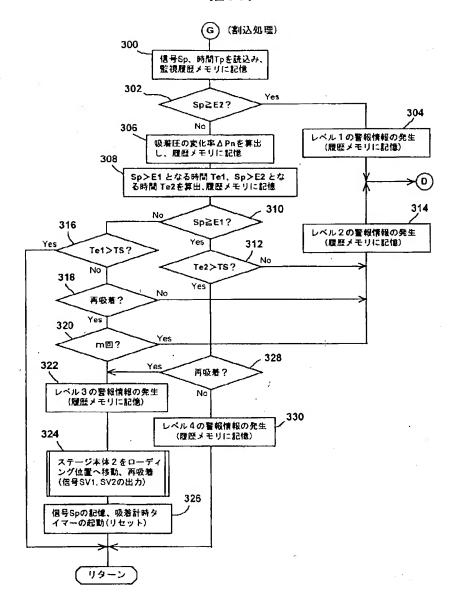


【図19】



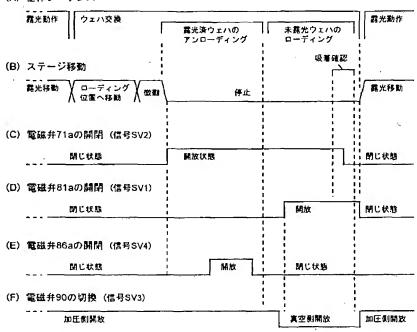


【図11】

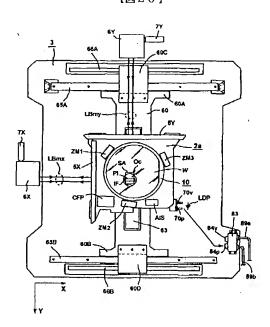


【図14】





【図20】



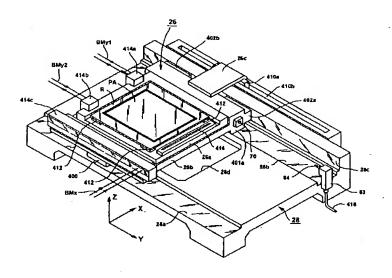
【図23】

全体動作	松米龍	鶴光済みウェハのアンローディング Qaa体は、リフトピン上昇 アーム老人(リフトピン版下「アーム近出	ロードインクーアーンを	ンントピン原下	中部7-4	未開光,	未解光ウェハのロードィングアーム過入。 リフトピン上降 「アーム過入」	7 通讯	- リフトピン時下 (ウェバ吸着(略認)	ウェハ穀塩(硫認)
•	加压例								-	
7.									其	
4 语 4 年 8 1 a	湖野	到政	類				監故			遍開
排 排 86.0	温斯 阿枝			建断		英屋			阿	
4 田			 	加王郎				ļ	加王側	`
150 Z		真空側					真空侧			
特田井	`	加压侧					加田側			
7 23 .				大気御					大気側	
140	過過							五数	刺	
拼辞		大気御				1	Γ			
141	真空側			:						

{.

.

【図24】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁶

識別記号

F I H O l L 21/30

516B

B23Q 1/14

Z